

Trust the People
Who Founded the Dedicated
Foundry Business

八十七年度年報

台灣積體電路製造股份有限公司

辦事處名稱

公司本部及晶圓二廠、五廠

新竹科學工業園區區三路121號

電話：886-3-578-0221 傳真：886-3-578-1546

晶圓一廠

新竹縣竹東鎮中興路四段195號67館

電話：886-3-582-1240 傳真：886-3-582-2616

晶圓三廠、四廠

新竹科學工業園區研新一路9號

電話：886-3-578-1688 傳真：886-3-578-1548

美國子公司

1740 Technology Drive, Suite 660, San Jose,

CA 95110, U.S.A.

電話：1-408-437-8762 傳真：1-408-441-7713

32 Thorn Oak, Dove Canyon,

CA 92629, U.S.A.

電話：1-949-459-7855 傳真：1-949-459-9489

歐洲子公司

World Trade Center, Strawinskylaan 1145,

1077 XX Amsterdam, The Netherlands

電話：31-20-305-9900 傳真：31-20-305-9911

日本子公司

16F, Queen's Tower C, 2-3-5

Minato Mirai, Nishi-Ku, Yokohama,

Kanagawa 220-6216, Japan

電話：81-45-682-0670 傳真：81-45-682-0673

公司發言人

姓名：黃彥群

職稱：副總經理

電話：886-3-578-0221 傳真：886-3-578-1545

公司網址

<http://www.tsmc.com.tw>

簽證會計師

事務所名稱：勤業會計師事務所

會計師姓名：黃樹傑、魏永篤

地址：台北市民生東路三段156號12樓

電話：886-2-2545-9988 傳真：886-2-2545-9966

辦理股票過戶機構

中國信託商業銀行代理部

台北市重慶南路一段83號5樓

電話：886-2-2361-3033 傳真：886-2-2311-6723

美國存託憑證(ADR)存託銀行

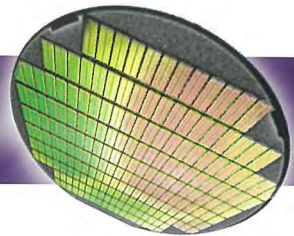
Citibank, N.A.

Depository Services Department

21Fl., 111 Wall Street, New York,

NY 10043, U.S.A.

電話：1-212-657-1853 傳真：1-212-825-2103



目錄

致股東營業報告書 3

公司概況 7

- 一、公司簡介
- 二、組織表
- 三、董事及監察人
- 四、主要經理人
- 五、公司債及特別股之發行與執行情形

營運概況 13

- 一、業務內容
- 二、市場及行銷
- 三、市場分析
- 四、轉投資事業
- 五、最近三年度從業員工人數
- 六、勞資關係
- 七、環境保護措施
- 八、重要契約
- 九、訴訟及非訟事件
- 十、公元兩千年電腦年序問題(Y2K)之因應

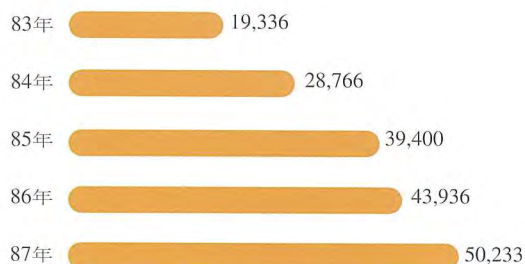
營業計畫 25

- 一、八十八年度產銷計畫
- 二、八十八年度增資擴充計畫
- 三、研究發展計畫

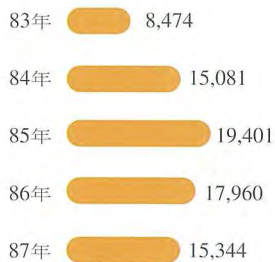
財務資料 29

- 一、簡明資產負債表
- 二、簡明損益表
- 三、財務分析
- 四、每股淨值、盈餘、股利及市價
- 五、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
- 六、監察人審查報告書
- 七、內部控制聲明書
- 八、財務報表暨會計師查核報告書
- 九、財務狀況及經營結果之檢討分析
- 十、合併財務報表

營業收入 新台幣百萬元



稅後純益 新台幣百萬元



每股盈餘 新台幣元



經營理念

堅持高度職業道德

專注於「專業積體電路製造服務」本業

放眼世界市場，國際化經營

注意長期策略，追求永續經營

客戶是我們的夥伴

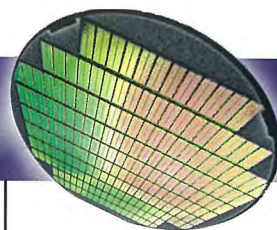
品質是我們工作與服務的原則

鼓勵在各方面的創新，確保高度企業活力

營造具挑戰性、有樂趣的工作環境

建立開放型管理模式

兼顧員工福利與股東權益，盡力回饋社會



各位股東女士、先生：

民國八十七年對全球半導體產業而言是相當艱辛的一年，由於產能供過於求導致產品價格下滑，全球總產值較民國八十六年衰退了8.4%。在此環境下，台積公司八十七年的營業額仍較八十六年成長了14.3%，達到新台幣502億3千3百萬元的歷史新高水準，稅後純益為新台幣153億4千4百萬元，每股盈餘2.54元。雖然我們的盈餘因為產業景氣不佳而難免受到影響，較八十六年下滑14.6%，然而我們30.5%的獲利能力仍然領先了全球大多數的半導體製造業者。

在過去一年中，台積公司在經營管理上的卓越表現，無論在國內或國際上皆獲得高度的評價及肯定。在天下雜誌八十七年度的標竿企業聲望調查中，我們連續第二年獲得第一名；在遠東經濟評論 (*Far Eastern Economic Review*) 同年的亞洲200大企業排行榜中，台積公司亦高居台灣十大企業榜首；在亞洲商業週刊 (*Asian Business*) 的亞洲最具聲望企業讀者票選中，我們亦獲選為「最佳台灣企業」之殊榮；亞洲貨幣雜誌 (*AsiaMoney*) 更評選本公司為當年度亞洲區管理最佳一百家企業的第一名。台積公司世界級的經營績效及成果，在在展現出我們因應競爭環境挑戰的堅強實力。

技術領先

持續不斷的技术發展，是我們提高競爭優勢的重要關鍵之一。台積公司在最新技術的研發及導入生產方面，不但在專業積體電路製造服務領域中居領先地位，並且已經能夠和全球半導體領導廠商並駕齊驅。



董事長
張忠謀

民國八十七年我們完成許多先進製程技術上的重大發展，例如0.18微米邏輯製程、銅製程，以及應用於快速發展的系統單晶片(system-on-a-chip)上的嵌入式製程技術。我們的0.18微米邏輯製程具有世界最嚴格的設計準則，成功地試產出低電壓、高效能的產品。此外，我們也是全球第一家能夠彈性地因應客戶不同需求，同時提供高良率0.18微米鋁製程及銅製程技術的專業積體電路製造服務公司。這些技術發展的具體行動與成果，顯示出我們一直以最快的速度，提供客戶最先進技術的堅持與決心。

產能提升

由於預期客戶對深次微米的製程技術需求將增加，本公司在產能持續擴充的策略下，八十七年十二月份的單月產能達到15萬3千片八吋晶圓規模，較八十六年同期的11萬9千7百片增加了28%。新增加的產能大多集中於0.35及0.25微米製程技術，以確保先進技術之產能隨時領先客戶的需求。然而，由於受到全球半導體業景氣低迷的影響，八十七年的晶片總出貨量為120萬片八吋晶圓，僅與八十六年相當。

台積公司的接單量在民國八十七年底開始明顯轉強，我們預期這樣的趨勢將會持續到民國八十八年，整個半導體市場亦可望如市場預測般，自八十七年的低潮中反彈。以目前的產能，加上在八十八年度新增的產能，我們有信心在這波景氣復甦中能夠充份滿足客戶不斷成長的需求。

全球營運

台積公司是唯一能在全球數個不同地點，提供豐沛產能及一流服務的專業積體電路製造服務公司。截至八十七年底止，除了在國內的新竹科學園區已設有五座廠房之外，在台南科學園區的晶圓六廠亦已在興建中；而位於美國華盛頓州與客戶合資設立的WaferTech公司，也在八十七年中開始量產。此外，在八十七年九月我們也宣佈與荷蘭飛利浦公司及新加坡投資私人有限公司(Singapore EBD Investments)，共同在新加坡投資興建晶圓廠。以上種種，都是台積公司致力於提供客戶優良供貨來源



總經理
曾繁城

及品質的實證，同時也與台積公司長期產能持續擴充之策略並行不悖。

除了營運據點，本公司的堅實客戶群也遍佈全球；美洲地區一直是我們最主要的市場，營業額佔公司營收的57%，亞洲客戶佔32%，來自歐洲客戶的業務則佔了公司整體營收的11%。

公眾服務

台積公司深切了解企業的成功與成長要靠社會及環境的配合，因此在專注於本業經營的同時，我們也致力於成為良好的企業公民。我們的努力之一便是在八十七年四月時成立了台積電文教基金會，選定「推動科技教育與人才培訓」、「贊助文藝活動」及「參與社區總體營造」三大方向為主軸，進一步貢獻我們的力量。

公司願景及未來展望

台積公司的願景是做一個全球最有聲譽、以服務為導向，並替客戶創造最大利益的專業積體電路製造服務公司，因而成為獲利最高的一流半導體企業。為了達成此願景，我們將持續專注於專業積體電路製造服務的本業，並實踐我們的承諾，成為客戶的虛擬晶圓廠。

展望民國八十八年，全球半導體產業可望擺脫八十七年衰退的景況。而長期而言，專業積體電路製造服務將在全球半導體製造業中扮演更重要的角色，除了積體電路設計公司外，整合元件製造大廠

(IDM)也將向外尋求與專業積體電路製造服務公司的合作。我們相信在堅實的「虛擬晶圓廠」策略下，本公司必能不斷為客戶提供最好的服務，繼續保持在全球專業積體電路製造服務市場的領導地位。

最後，要感謝我們的客戶、各位股東女士、先生以及努力不懈的員工，對您們長久以來的不斷支持，謹致上最誠摯的謝忱！

董事長

張忠謀



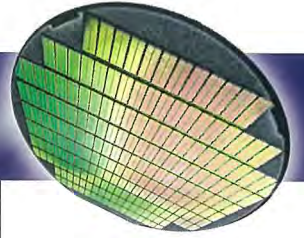
總經理

曾繁城



台積對客戶的承諾，
讓我們高枕無憂。





一、公司簡介

台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱台積公司)，成立於民國七十六年，並於民國八十三年成為在台灣證券交易所掛牌之上市公司。本公司之美國存託憑證亦於民國八十六年在美国紐約證券交易所(NYSE)以TSM為代號開始掛牌交易。

本公司位於有台灣矽谷之稱的新竹科學工業園區，是全球第一家以最先進的製程技術提供專業積體電路製造服務(即一般所謂「晶圓代工」)的公司，不設計或生產自有品牌產品，而提供所有的產能為客戶服務。由於此項策略與堅持，使本公司成立以來，不但成為全球積體電路業者最忠實的伙伴，更確立了全球積體電路產業的專業分工模式。目前全球專業積體電路製造服務已發展成為一個年營業額數十億美元的產業，而在半導體產業持續分工以及新晶圓廠投資日益龐大的趨勢下，專業積體電路製造服務公司有非常大的機會成為全球半導體製造產能的主要供應來源。

截至民國八十七年底，本公司擁有六吋積體電路晶圓廠兩座(晶圓一、二廠)，八吋晶圓廠三座(晶圓三、四、五廠)，八十七年年產能達到160萬片八吋晶圓(約當量)，是世界最大的專業積體電路製造服

務公司。我們在台南科學園區的第一座晶圓廠 -- 「晶圓六廠」也已動工興建，預計在民國八十九年開始量產。除了台灣之外，我們也不斷在全世界主要市場建立基地，例如美國、歐洲、日本的子公司，以及與客戶合資設立的專業積體電路製造服務公司--WaferTech。位於美國華盛頓州的WaferTech公司，已經在民國八十七年中開始出貨給客戶。此外，在八十七年九月本公司更宣佈了與荷蘭飛利浦公司及新加坡投資私人有限公司在新加坡共同興建晶圓廠的計畫，更進一步擴張在全球的營運版圖。

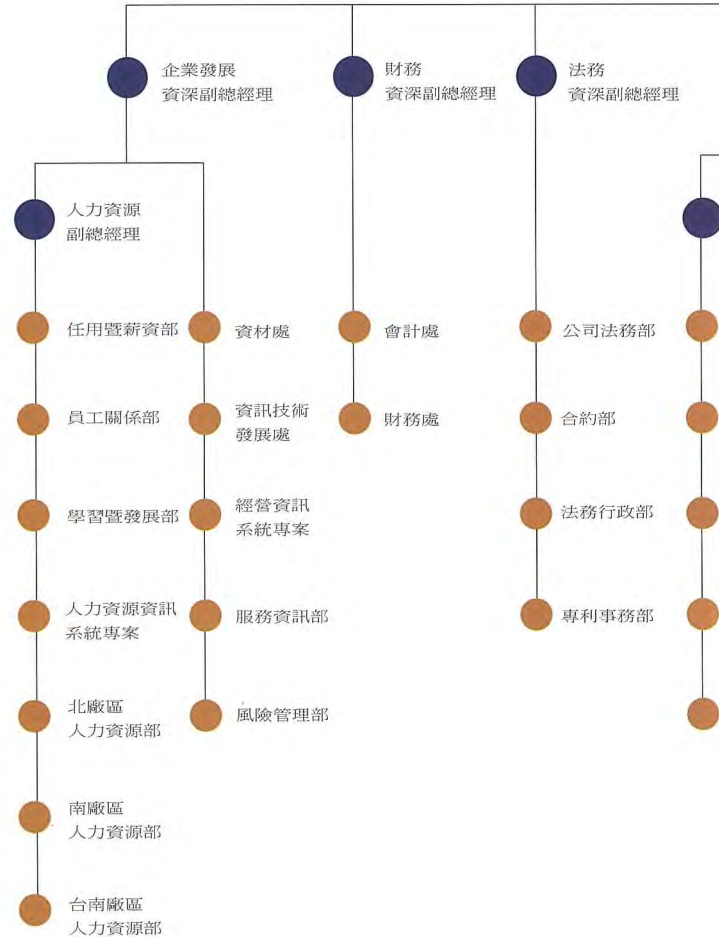
除了產能優勢外，本公司亦不斷開發新一世代之量產製程技術，以確保技術的領先。我們提供全面的各類積體電路製程，例如互補金氧半導體邏輯製程(CMOS Logic)、類比/數位混合製程(mixed-signal)、系統單晶片或嵌入式(embedded)記憶體製程、雙載子互補金氧半導體製程(BiCMOS)技術，以及設計支援服務來充份滿足不同客戶的各種需求。我們堅信，唯有如此才能真正提供最大的附加價值給客戶，也才能成為客戶最佳的合作夥伴。

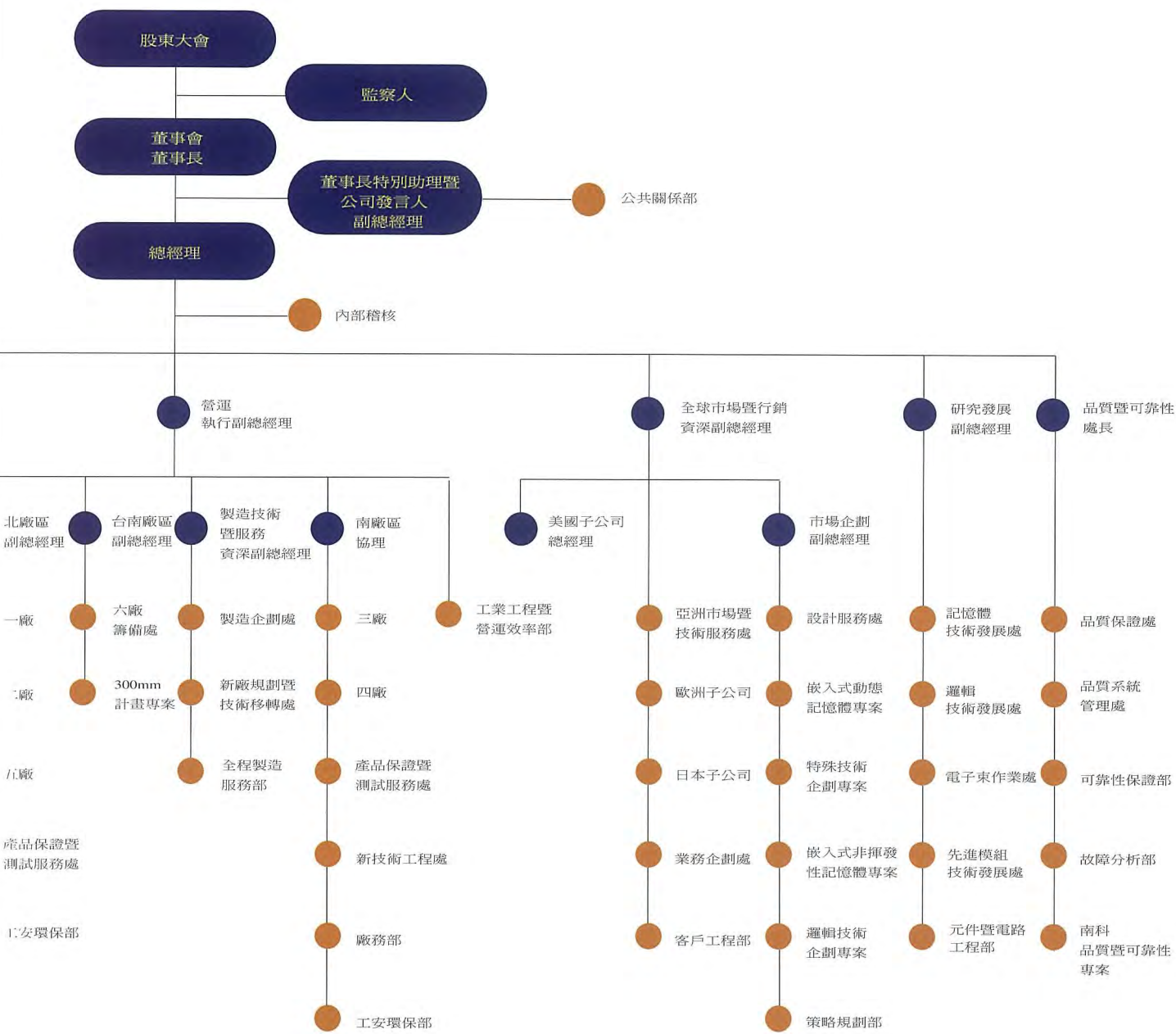
要在專業積體電路製造服務業中贏得長期的勝利，除了最佳的製程技術、品質及領先的產能優勢外，服務水準尤為關鍵所在。本公司提出成為客戶「虛

擬晶圓廠」的策略，其目標就是提供客戶最好的服務，給予他們所有相當於擁有自己晶圓廠的便利與好處，而同時免除客戶自行設廠所需的大筆資金投入及管理上的問題。在此策略領導下，本公司將能構建更大的競爭優勢，並鞏固在專業積體電路製造服務業中的領導地位。

本公司自成立以來，一直致力於技術及市場的領先，並以實際行動回饋員工、股東及社會大眾，歷年來屢獲政府單位頒發環境保護、污染防治、工業安全、人力培訓、員工福利、熱心公益等績優企業獎項，並被中外著名媒體評選為台灣最佳標竿企業。而董事長張忠謀博士不僅獲得美國商業週刊評選為1997年全球最佳專業經理人之一，更獲得美國投資銀行BancAmerica Robertson Stephens遴選為半導體業五十年歷史最具貢獻者之一。

二、組織表





三、董事及監察人

本資料基準日為88年2月28日

職稱 姓名	選任 日期	任期 (年)	持有股份	配偶及未成年 子女持有股份	主要學經歷	備註
董事長 張忠謀	86.05.13	3	35,320,708	0	美國史丹福大學電機工程博士/世界先進積體電路(股)公司董事長/台灣慧智(股)公司董事長/本公司董事長	
董事 范德普	86.05.13	3	1,053,565,770	0	荷蘭Eindhoven技術大學電子工程系/ 飛利浦半導體國際(股)公司董事長暨執行長	荷蘭商飛利浦電子 股份有限公司代表人
董事 羅貝茲	86.05.13	3	1,053,565,770	0	荷蘭 Erasmus 大學商業經濟系 飛利浦半導體國際(股)公司財務總長	荷蘭商飛利浦電子 股份有限公司代表人
董事 柯慈雷	86.05.13	3	1,053,565,770	0	荷蘭 Eindhoven 技術大學電子工程系/ 飛利浦在台各企業組織總裁	荷蘭商飛利浦電子 股份有限公司代表人
董事 許祿寶	86.05.13	3	1,053,565,770	0	國立成功大學物理系/ 飛利浦在台各企業組織諮議資政	荷蘭商飛利浦電子 股份有限公司代表人
董事 蔡宗榮	86.05.13	3	991,069,594	0	美國密西根州立大學經濟研究所博士/ 行政院開發基金管理委員會副執行秘書	行政院開發基金管理 委員會代表人
董事 顏慶章	86.05.13	3	991,069,594	0	美國密西根大學法學碩士/ 財政部政務次長	行政院開發基金管理 委員會代表人
董事 史欽泰	86.05.13	3	991,069,594	0	美國普林斯頓大學電機博士/ 工業技術研究院院長	行政院開發基金管理 委員會代表人
董事 吳亦圭	86.05.13	3	13,662,500	0	中國海專/ 順昶塑膠公司董事長	懋昌投資 股份有限公司代表人
董事 曾繁城	86.05.13	3	9,513,763	40,511	國立成功大學電機工程博士/ 本公司總經理	
監察人 歐盛	86.05.13	3	1,053,565,770	0	荷蘭 Tilburg 大學經濟系/ 飛利浦在台各企業組織執行副總裁	荷蘭商飛利浦電子 股份有限公司代表人
監察人 胡仲英	86.05.13	3	991,069,594	0	中央大學理學博士/ 行政院經建會部門計畫處處長	行政院開發基金管理 委員會代表人
監察人 胡新南	86.05.13	3	8,791	0	美國密西根大學化工碩士/ 趙廷箴文教基金會董事長	

四、主要經理人

本資料基準日為88年2月28日

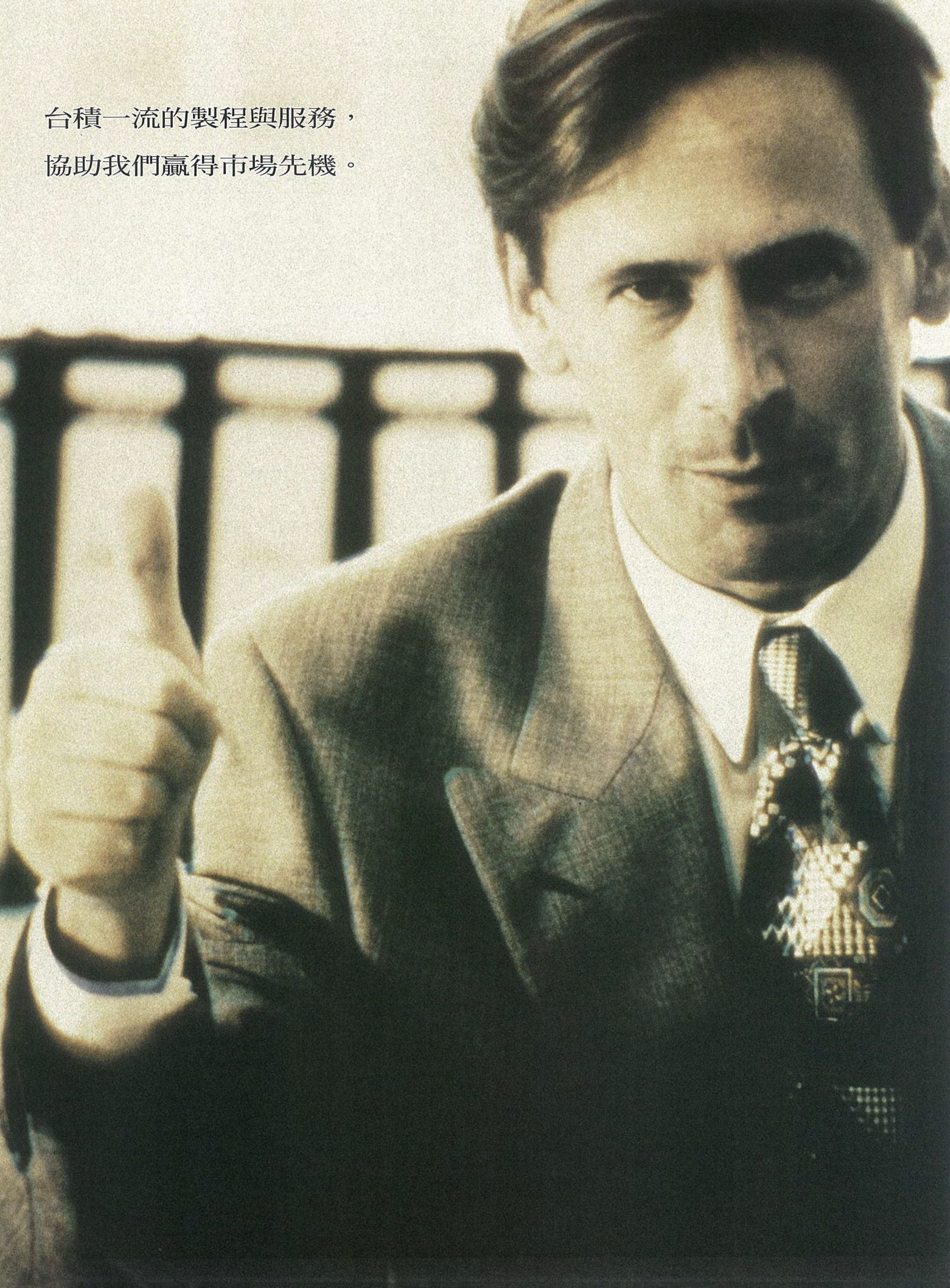
職稱 姓名	就任 日期	持有股份	配偶及未成年 子女持有股份	主要學經歷
總經理 曾繁城	87.05.12	9,513,763	40,511	國立成功大學電機工程博士/本公司營運資深副總經理/ 世界先進積體電路(股)公司總經理/本公司總經理
資深副總經理 林坤禧	84.09.01	5,366,975	867,564	美國肯塔基大學企管博士/本公司行銷暨業務副總經理/ 本公司企業發展資深副總經理

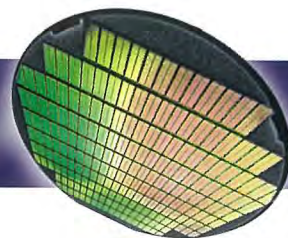
職稱 姓名	就任 日期	持有股份	配偶及未成年 子女持有股份	主要學經歷
資深副總經理 左大川	86.03.04	1,159,333	0	美國加州大學柏克萊分校材料科學博士/本公司全球市場暨行銷資深副總經理/本公司製造技術暨服務資深副總經理
資深副總經理 陳國慈	86.11.24	258,740	7,000	英國,美國加州暨新加坡律師/財團法人國家文化藝術基金會執行長/ 本公司資深副總經理暨法務長,以及台積電文教基金會董事長
資深副總經理 張孝威	87.02.03	110,000	0	美國賓州大學華頓商學院企管碩士/中華開發公司總經理/ 中華證券投資信託公司董事長/本公司資深副總經理暨財務長
資深副總經理 龍納德	87.11.10	7,250	0	美國阿肯色大學物理碩士/本公司美國子公司總經理/ 本公司全球市場暨行銷資深副總經理
副總經理 黃彥群	84.09.01	4,647,002	0	美國塞基諾大學企管碩士/本公司行政副總經理/ 本公司董事長特別助理暨發言人
副總經理 陳健邦	86.05.13	1,381,711	0	國立清華大學物理碩士/本公司北廠區副總經理/ 本公司台南廠區副總經理
副總經理 蔣尚義	86.08.05	715,767	0	美國史丹福大學電機工程博士/美國惠普科技公司實驗室元件研發及 應用部門經理/本公司研究發展副總經理
副總經理 楊平	86.11.18	522,672	20,907	美國伊利諾大學電機工程博士/美國德州儀器公司半導體製程及元件 中心處長/本公司市場企劃副總經理
副總經理 魏哲家	87.03.03	400,000	400	美國耶魯大學電機工程博士/新加坡特許半導體公司技術資深副總經理/ 本公司北廠區副總經理
副總經理 李瑞華	87.08.11	0	0	美國史丹福大學管理碩士/朗訊科技亞太有限公司副總裁/ 本公司人力資源副總經理

五、公司債及特別股之發行與執行情形

種類	發行日期	期間	票面利率(或到期殖利率)	流通在外金額	執行情形
美金三億伍仟萬元 海外可轉換公司債	86.07.03	五年	到期殖利率6.28% (零息票, 到期以面額之136.23%償還)	美金三億伍仟萬元	已完成
新台幣四十億元 普通公司債	87.03.04	五年	年息7.71%	新台幣四十億元	已完成
新台幣六十億元 普通公司債	87.11.18- 87.12.01	五年	年息7.12%	新台幣六十億元	自88年1月開始,預計於88年 第三季完成

台積一流的製程與服務，
協助我們贏得市場先機。





一、業務內容

(一) 業務範圍

台積公司專注於「專業積體電路製造服務」之本業，以卓越的製造與服務能力為核心競爭優勢，致力於提供全球半導體廠商極大型及超大型積體電路晶圓製造、晶圓針測、包裝及測試、光罩製作、設計服務等全系列的各項服務，其中積體電路晶圓製造佔公司整體營收之九成左右。

過去十一年來，我們的客戶已利用本公司的製造服務，生產出各種應用層面的積體電路。據估計，在民國八十七年全球積體電路產品中，大約有3%是透過本公司所提供的服務所產製的。

(二) 主要產品之用途

本公司經由提供整體的專業積體電路製造服務，協助客戶的產品應用於電腦、通訊、消費性電子產品、汽車及工業用設備等各項系統及產品之中。

二、市場及行銷

雖然面臨全球半導體市場低迷與專業積體電路製造服務產業競爭者日眾的壓力，本公司在民國八十七年仍締造了營業額新台幣502億及獲利153億的亮麗成績。來自美國地區客戶的業務佔公司整體營收的57%，亞洲客戶佔32%，歐洲客戶則佔11%。

本公司之所以能有如此優異的表現，首先要歸功於我們經過十餘年努力所累積的龐大客戶基礎與堅強客戶關係。本公司擁有為數超過400家的客戶，其中超過五成在去年向本公司下單。龐大的客戶基礎，意謂風險分散的程度提高；在不景氣時，績效卓越的客戶持續向本公司下單是去年一年本公司得以保持成長的重要原因。另外，策略運用的正確與組織再造的成功，亦是本公司得以持續成長的重要原因。在策略上，本公司一向謹慎控制對記憶體市場的涉入程度，使得本公司得以將記憶體價格滑落的不利影響降至最低。另一方面，基於專業積體電路製造服務市場的競爭逐漸加劇，進入者日眾，為著眼於長期競爭力的培養，本公司在民國八十五年投入企業再造，已逐漸看到成果。過去以生產為導

最近五年度生產量值表

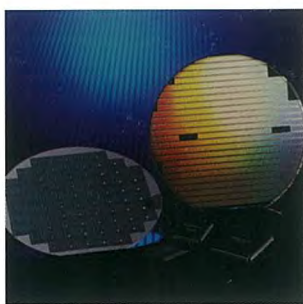
單位：產能/產量（片，八吋晶圓約當量） 產值（新台幣仟元）

年度	晶圓			包裝元件			其他		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值	產能	產量	產值
83年	514,247	527,876	8,699,044	-	-	-	-	-	-
84年	643,764	679,532	11,507,350	-	-	-	-	-	-
85年	880,837	843,755	16,721,361	-	-	-	-	-	-
86年	1,177,393	1,206,165	28,343,668	-	-	-	-	-	-
87年	1,617,231	1,202,922	28,169,217	-	-	-	-	-	-

最近五年度銷售量值表

單位：量（片，八吋晶圓約當量） 值（新台幣仟元）

年度	晶圓				包裝元件				其他				合計			
	內銷		外銷		內銷		外銷		內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值
83年	158,758	5,526,433	325,160	10,748,451	1,620	99,647	31,661	2,212,963	-	312,873	-	435,704	160,378	5,938,953	356,820	13,397,118
84年	192,512	8,540,012	448,034	16,589,558	1,856	139,081	25,916	2,115,917	-	597,449	-	783,974	194,368	9,276,542	473,951	19,489,449
85年	247,171	9,735,637	550,779	26,278,058	4,157	378,020	14,324	1,119,274	-	886,343	-	1,002,847	251,328	11,000,000	565,103	28,400,179
86年	308,616	9,963,659	796,345	29,248,555	11,000	806,301	28,950	1,803,038	-	780,892	-	1,333,182	319,616	11,550,852	825,295	32,384,775
87年	289,232	10,402,803	842,280	34,468,771	9,259	668,222	35,632	2,897,781	-	392,713	-	1,402,718	298,491	11,463,738	877,912	38,769,270



向的組織型態已改變成以服務為本位、技術人才也具有行銷技能的服務型組織，不僅員工個人得以進一步成長，公司亦得以藉此提高產業進入障礙，並實現「成為客戶虛擬晶圓廠」的目標。

三、市場分析

台積公司用於生產積體電路的主要原料為矽晶圓、製程用化學原料、光阻及特殊氣體。針對每一種原料本公司皆與數家世界主要製造商合作，由於供應商之間有替代性及競爭性，本公司因此得以確保原料供應的穩定無虞，並能掌握原料品質、交期、以及合理的價格與完善的服務。

全球半導體市場在民國八十六年出現了約5.6%的成長後，復於民國八十七年衰退了8.4%。其中記憶體市場因平均每一位元單價仍持續滑落，而導致市場規模衰退了約21%外，其它的邏輯元件市場亦因市場買氣不振而有5%的衰退幅度。展望未來，民國八十八年全球半導體市場將有約10%至15%左右的成長，其中記憶體市場將隨著新應用的不斷推出與供需逐漸趨向平衡而有顯著成長的可能性，邏輯元件市場亦將有6%到12%的成長率。

過去幾年，本公司策略性地控制了投入記憶體市場的程度，務使記憶體製造服務總額不超過公司營業額的一定百分比。這個策略曾在民國八十五、八十

六年全球記憶體市場近乎自由落體般滑落的情況下，成功地保護本公司得以成長無礙；民國八十七年記憶體市場持續衰退，此一策略對本公司的經營仍產生正面的影響。民國八十八年，我們在記憶體市場上，除仍將持續執行「不高於營業額之一定百分比」的策略外，另外亦將針對逐漸成長的嵌入式記憶體應用市場加強技術與客戶的開發。

在邏輯元件市場方面，本公司亦將致力於爭取該市場中高成長區隔與高先進技術需求的客戶。民國八十七年在繪圖晶片、網際網路、數位消費性電子與無線通訊產業均有新客戶的引進與產品的生產，這些新客戶有些已在八十七年對本公司的營運產生相當大的助益，有些則將在未來幾年大量使用本公司的先進技術與產能。長期而言，將確保本公司未來在專業積體電路製造服務產業中保有高度的成長。

放眼未來，我們深信專業積體電路製造服務將在全球半導體產業的生產製造上扮演愈來愈重要的角色。無晶圓廠的積體電路設計公司已經仰賴專業積體電路製造服務公司提供製造服務，而有晶圓廠的整合元件製造公司也將逐漸增加對專業積體電路製造服務公司的下單。到民國八十九年，全球半導體預計將有15%的產品自專業積體電路製造服務公司生產出，民國九十七年此一比例更將達到25%至30%。

除了全球半導體產業專業分工趨勢明顯的有利因素外，多媒體的興起、低價電腦與網際網路的風行，也造成晶片整合需求的提昇，增加了客戶對本公司先進技術的需求，有利本公司進行先進技術產能的擴充，並維持平均銷售單價於不墜。

至於對專業積體電路製造服務產業較不利的因素，則是短期內的產能過剩與未來可能面臨諸多新進入者的激烈競爭壓力。但以本公司在專業積體電路製造服務第一品牌的市場地位，加上堅實的客戶關係及先進的技術與整體服務，我們應能繼續維持獲利能力與領導地位。

本公司未來將專注於以下製造服務技術的提供：

（一）先進的互補金氧半導體邏輯製程

民國八十七年初客戶已成功地運用本公司所提供的0.25微米互補金氧半導體(CMOS)邏輯製程發展新產品並進行量產，0.22微米技術亦已在八十七年年底進入量產。為緊密配合市場變遷、協助客戶推出新產品，0.18微米CMOS邏輯製程技術也將在民國八十八年第一季進入量產，而0.15微米製程則預計於民國八十九年初開始量產。這些先進的製程將為本公司的客戶提供功能更強、整合度更高的生產技術，而使客戶保有在產品性能及成本效益的優勢。

（二）先進的類比/數位訊號製程

在類比/數位訊號的應用市場上，本公司已於民國八十七年初成功開發出0.25微米雙層矽晶、五層金屬製程，並於該年順利進入量產，建立了本公司在消



費性電子、資訊傳輸與通訊網路積體電路上獨特的生產服務地位。同時，多媒體產品亦需要

此一類比/數位混合製程，以利數位訊號處理技術及媒體處理技術的應用。而0.18微米技術則將於民國八十八年下半年完成。

（三）先進的靜態隨機存取記憶體及嵌入式靜態隨機存取記憶體製程

本公司在民國八十七年已提供0.25微米高速靜態隨機存取記憶體技術供客戶使用，0.25微米低功率靜態隨機存取記憶體技術亦已在八十七年開發完成並進入量產。至於0.18微米的技術預計將在八十八年開發完成並進入量產。在嵌入式靜態隨機存取記憶體技術方面，本公司則已於民國八十七年底完成0.25微米一層矽晶、五層金屬技術的開發，並隨即進入量產提供給客戶使用。至於0.18微米嵌入式靜態隨機存取記憶體製程則將與0.18微米邏輯製程同時完成，以協助客戶降低成本並提高產品性能。

（四）先進的動態隨機存取記憶體及嵌入式動態隨機存取記憶體製程

本公司已於民國八十七年完成0.25微米動態隨機存取記憶體製程技術的開發及量產；0.35微米嵌入式動態隨機存取記憶體技術的開發也已在八十六年完成，並在八十七年正式提供給客戶使用。0.25微米嵌入式動態隨機存取記憶體製程技術將在八十八年第二季進入量產，協助客戶在筆記型電腦繪圖晶片、資料儲存、通訊應用及數位消費性電子領域中掌握廣大商機。至於0.21與0.19微米的動態隨機存取記憶體製程，則預計在民國八十八年下半年研發完成。

（五）先進的快閃記憶體及嵌入式快閃記憶體製程

在非揮發性記憶體方面，本公司於民國八十七年年中與年底分別研發完成0.35微米以邏輯電路為主的雙層矽晶、雙層金屬、分離式閘極快閃記憶體製程技術，與0.35微米類比/數位混合訊號雙層矽晶、四層金屬、分離式閘極嵌入式快閃記憶體技術。這些製程將提供客戶整合快閃記憶體與邏輯元件於同一晶片上的能力，特別是在需要高度整合的應用上如微控制器、數位訊號處理與其它系統單晶片整合技術等。另外，0.25微米的快閃記憶體及嵌入式快閃

記憶體製程技術亦預計可在民國八十八年完成研發並進入量產。

（六）特殊邏輯製程

除了先進製程的研發，本公司亦於民國八十七年投入針對利基市場的特殊製程開發，包括互補式金氧半導體影像感應器與高電壓製程。互補式金氧半導體影像感應器製程已於八十七年完成0.8與0.6微米的開發，0.5與0.35微米製程則預計在八十八年可以完成開發並進入量產。高電壓製程則在八十七年完成1.0與0.8微米單層矽晶、雙層金屬與1.0微米雙層矽晶、雙層金屬製程的開發，並將於八十八年進入量產。本公司預計在八十八年進行0.6與0.5微米高電壓製程的開發與量產。

（七）設計服務

本公司0.25微米的標準電路元件庫已於民國八十七年開發完成並為客戶所使用，0.18微米也將從民國八十八年第一季開始陸續開發完成。另外0.18微米的巨集如類比/數位轉換器、鎖相迴路、數位訊號處理器等與0.18微米的設計工具，也將在民國八十八年年初提供客戶使用。本公司於民國八十七年開始與專業智財權公司進行策略聯盟，對客戶提供更快速、更廣泛與品質更好的設計支援服務，以因應市場上整合性晶片加速推出的需求。

四、轉投資事業

(本資料基準日為87年12月31日)
單位: 除投資股份外, 均為新台幣仟元

轉投資事業	主要營業範圍	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額	
				股數	股權比例(%)				投資(損)益	分配股利	投資成本	股權比例(%)
台灣光罩股份有限公司	光罩製作	32,129	32,129	5,589,953	2.35	255,997	284,041	成本法	-	37,211	-	-
台灣積體電路製造股份有限公司美國子公司	市場行銷及工程支援	25,588	178,294	1,000,000	100.00	178,294	-	權益法	42,063	-	-	-
台灣積體電路製造股份有限公司歐洲子公司	市場行銷及工程支援	2,960	25,077	200	100.00	25,077	-	權益法	1,541	-	-	-
台灣積體電路製造股份有限公司日本子公司	市場行銷及工程支援	7,440	9,287	600	100.00	9,287	-	權益法	2,256	-	-	-
世界先進積體電路股份有限公司	積體電路設計製造	5,682,367	4,723,014	521,417,518	25.81	4,577,814	10,011,216	權益法	(1,400,026)	-	-	-
台積國際投資股份有限公司	半導體相關事業投資	11,045,068	11,096,090	379,788,244	100.00	11,096,090	-	權益法	(1,356,890)	-	-	-
聯亞氣體工業股份有限公司	液氮,氮氣產品製造及銷售業務	146,250	146,250	8,745,750	11.25	135,222	-	成本法	-	11,408	-	-
台灣信越半導體股份有限公司	矽晶圓產品研發製造及銷售	105,000	105,000	10,500,000	7.00	67,265	-	成本法	-	-	-	-
普實創業投資股份有限公司	創業投資及相關業務	50,000	50,000	5,000,000	4.17	55,136	-	成本法	-	-	-	-
柏成投資有限公司	投資業務	100,000	100,657	-	25.00	100,657	-	權益法	657	-	3,405	0
啟信投資有限公司	投資業務	100,000	100,659	-	25.00	100,659	-	權益法	659	-	3,405	0

轉投資事業	主要營業範圍	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額	
				股數	股權比例(%)				投資(損)益	分配股利	投資成本	股權比例(%)
積成投資有限公司	投資業務	100,000	100,661	-	25.00	100,661	-	權益法	661	-	51,771	0.01
欣瑞投資有限公司	投資業務	100,000	100,641	-	25.00	100,641	-	權益法	641	-	3,405	0
承暉投資有限公司	投資業務	100,000	100,643	-	25.00	100,643	-	權益法	643	-	3,405	0
功成投資有限公司	投資業務	100,000	100,680	-	25.00	100,680	-	權益法	680	-	50,509	0.01
宏通創業投資股份有限公司	創業投資及相關業務	40,000	40,000	4,000,000	10.00	40,177	-	成本法	-	-	-	-
台宏半導體股份有限公司	積體電路封裝及相關業務	500,000	500,000	50,000,000	18.87	498,312	-	成本法	-	-	-	-
TSMC Partners	投資業務	10,350	9,653	300,000	100.00	9,653	-	權益法	(55)	-	74,491 (美金\$2,278仟元) 美國存託憑證	0
Crimson Asia Capital	亞洲投資業務	19,030	19,030	-	-	18,504	-	成本法	-	-	-	-

五、最近三年度從業員工人數

年度	員工人數				平均年齡	平均年資	學歷分佈比率					
	直接員工	工程類	管理類	合計			博士	碩士	大學	高中	高中以下	合計
85年	1,830	1,715	572	4,117	28	3.5	1.8%	19.0%	37.8%	41.3%	0.1%	100.0%
86年	2,712	2,200	681	5,593	28	3.3	1.8%	20.0%	37.6%	40.5%	0.1%	100.0%
87年	2,711	2,467	730	5,908	29	3.9	2.2%	22.2%	37.7%	37.8%	0.1%	100.0%

六、勞資關係

台積公司勞資關係政策致力於營造一個勞資間互信的氣氛，同時重視內部的溝通。因此，員工們都能以對待客戶的尊重態度來對待自己的工作夥伴，勞資關係十分和諧。

在民國八十七年裡，為因應未來另一個十年的營運發展需要，本公司規劃並推動「員工績效管理與發展」之人力再造工程，以提昇員工之素質及生產力為目標，進而厚植公司整體的競爭力。

雖然八十七年遭逢全球性之景氣低迷期，但全體員工均能同心協力配合公司降低營運成本之規劃，並在生產空檔中加強多技能訓練，以期景氣復甦時能為公司創造更高的獲利。

七、環境保護措施

一如以往之持續改善理念，我們在民國八十七年同樣完成了多項污染預防方案，不僅可以降低污染物的產生，也同時得到了降低成本的好處。這些污染預防方案包括酸類化學品減量、過氟化物(溫室效應氣體之一種)用量最佳化，以及硫酸回收再利用等。八十七年四月，台積公司代表台灣半導體產業協會在由美國環保署舉辦之「全球半導體產業過氟化物

排放減量研討會」上，發表本公司在這方面所做之努力與成果。此外，在同年五月，我們也在「邁向二十一世紀：環境與能源研討會」上，發表能源查核計畫之結果。

行政院環保署為降低交通工具造成之空氣污

染，選定新竹地區作為推廣電動機車之示範區域，本公司亦配合此推廣計畫，辦理電動機車試騎和宣導，以及機車排氣定期檢驗活動。此外，對於環保署之「ISO14001執行績效查核計畫」，以及工研院之「亞太經合會ISO14001經驗交流訓練班」，本公司亦積極配合協助辦理。

台積公司加入了由十五個世界知名半導體公司所組成的國際半導體開發研究機構SEMATECH。該機構不僅執行尖端生產技術之研發工作，並且有相當完善之安衛環保研究計畫，去年進行之計畫包括過氟化物減量、用水最佳化、能源查核、濕式蝕刻槽消防安全，以及安衛環保最佳化實務等。參與這些國際性計畫，使我們得以與各國際半導體公司互相比較學習，並從中找出持續改善之參考方向。



八、重要契約

(一) 技術合作契約

(1) 契約期間：民國八十六年七月九日至民國九十六年七月九日

(2) 契約內容：本公司與飛利浦公司簽訂技術合作契約，並按約定產品銷貨收入淨額之特定比例支付技術報酬金。

(3) 契約對象：荷蘭商飛利浦電子股份有限公司

(二) 次微米技術授權契約

(1) 契約期間：民國七十九年十一月二十日至民國八十九年十二月三十一日

(2) 契約內容：本公司與工研院簽訂次微米技術授權契約，應於五年內支付授權費新台幣壹億貳仟玖佰肆拾萬元(該等權利金已全數支付完畢)，並按約定產品銷貨收入淨額之特定比例支付權利金。

(3) 契約對象：工業技術研究院

(三) 房屋及設備租賃契約(一廠)

(1) 契約期間：民國八十六年四月一日至民國九十一年三月三十一日

(2) 契約內容：本公司向經濟部租用約定之房屋及機器設備。

(3) 契約對象：經濟部

(四) 土地及公用設施使用借貸契約(一廠)

(1) 契約期間：民國八十六年四月一日至民國九十一年三月三十一日

(2) 契約內容：本公司向工研院租用約定之土地及公用設備。

(3) 契約對象：工業技術研究院

(五) 產能選擇權契約

(1) 契約期間：民國八十四年至民國九十年

(2) 契約內容：本公司與歐、美、亞洲各地區委製品圓產品之客戶，簽訂預定未來數年之產能及其選擇權。至民國八十七年底已簽訂之客戶有十餘家。

(3) 契約對象：歐、美、亞洲等地區十餘家公司。

(六) 製造契約

(1) 契約期間：自WaferTech, LLC量產後起三年

(2) 契約內容：本公司有義務於WaferTech, LLC量產後三年內，向WaferTech, LLC購買其百分之八十五之產能，本公司亦有權購買其全部產能。若本公司無法購足其百分之八十五之產能，本公司應就未購足部份予以賠償。

(3) 契約對象：WaferTech, LLC.

(七) 供應契約

- (1)契約期間：自WaferTech, LLC量產後起三年
- (2)契約內容：本公司有義務提供且三家客戶有義務購買特定比例之WaferTech, LLC產能。若各合約當事人無法供應／購足其承諾之產能，違約者應就未購足部份賠償本約他方當事人。
- (3)契約對象：Analog Devices, Inc.
- Altera Corporation
- Integrated Silicon Solutions, Inc.

九、訴訟及非訟事件

(一) SRAM反傾銷調查

美商美光公司 (Micron Technology Inc.) 於民國八十六年二月對韓國及台灣輸美之靜態隨機存取記憶體 (SRAM) 提出傾銷控訴。美國國際貿易調查委員會業已於八十七年四月做出美國產業受有傷害之最終判決，商務部隨即於四月十六日公佈台灣各廠商之傾銷稅率。本公司因未獲判個別稅率，故適用41.30%之平均稅率。因SRAM佔本公司銷售比例極為有限，且本公司直接輸美之SRAM數量更少，預估對本公司無重大影響。

(二) DRAM反傾銷調查

美商美光公司 (Micron Technology Inc.) 於民國八十七年十月對台灣輸美之動態隨機存取記憶體 (DRAM) 提出傾銷控訴。美國國際貿易調查委員會於同年十二月初步判定有合理跡象顯示美國產業受有傷害。美國商務部預定於八十八年五月公佈台灣各廠商傾銷稅率之初判。因DRAM佔本公司銷售比例極為有限，且本公司直接輸美之DRAM數量更少，預估對本公司無重大影響。

十、公元兩千年電腦年序問題(Y2K)之因應

本公司很早便注意到解決公元兩千年電腦年序問題 (Y2K) 的重要性，並於八十六年十二月初成立「Y2K專案」，隨後並設置「Y2K專案決策指導委員會」、「Y2K專案核心團隊」及「Y2K專案辦公室」，藉以確保本公司所有業務不會受到公元兩千年電腦年序問題的波及。我們並制定Y2K專案白皮書，針對公元兩千年電腦年序問題的描述、解決方式、專案組織架構、角色及權責、執行方式與時程、專案處理流程、稽核管理、預算控制以及供應商管理等項目加以規範，我們的目標是在八十八年四月三十日前完成。

(一) 電腦化程度及影響

由於本公司各部門業務電腦化的程度均十分高，電腦系統的當機或不正確的運算處理均會影響到公司的重要業務，因此，本公司Y2K專案涵蓋全公司業務相關的軟硬體系統與生產設備。本公司Y2K專案包括：(1) 資訊技術基礎架構，(2) 商業套裝軟體，(3) 自行開發應用系統，(4) 製造設備，(5) 廠務設備，(6) 供應鏈等與全公司相關的業務，藉此劃分來解決其相關的公元兩千年電腦年序問題，並使各部門的系統與設備均能安然渡過公元兩千年。

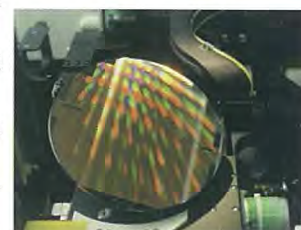
(二) 計畫進度及預算

針對全公司軟硬體系統與設備，本公司 Y2K專案將依序以 (1) 建立共識，(2) 清查現有系統，(3) 影響衝擊分析，(4) 制定因應計畫，(5) 系統修改，(6) 系統單一測試，(7) 系統整合測試，(8) 系統安裝，(9) 制定應變計畫，以及 (10) 稽核 等步驟來解決公元兩千年電腦年序的問題。截至目前為止，所有軟硬體系統與設備均依照進度進行，整個Y2K專案將投入六十三位專職人員及美金1千7百萬元。

(三) 可能的衝擊

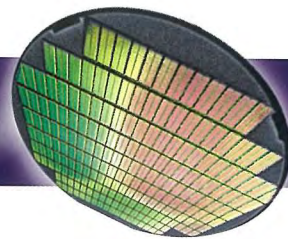
Y2K專案目前列為本公司最重要專案之一，由總經理擔任「Y2K專案決策指導委員會」主席，企業發展資深副總擔任Y2K專案之執行負責人並負責召開每週一次的Y2K專案會議。

「Y2K專案核心團隊」則負責確保各單位Y2K專案的進度與執行。我們已動員全公司所有資源並配合Y2K顧問共同來處理公元兩千年電腦年序問題，並且有完整的緊急應變計畫，因此，我們有信心使公元兩千年電腦年序問題的衝擊降到最低，並使本公司所提供的積體電路製造相關服務業務不受該問題的影響，而且維持原有的品質。



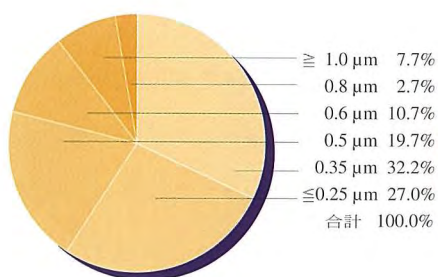
台積對客戶未來發展的關心，
和身為客戶的我們一樣殷切。



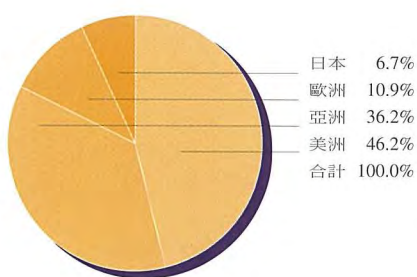


一、八十八年度產銷計畫

銷售計畫



各地區淨銷售比例



生產計畫



二、八十八年度增資擴充計畫

項目	金額(新台幣百萬元)	預計產生之效益
晶圓六廠廠房興建	4,620	預計於八十九年開始生產八吋晶圓
晶圓五廠	6,930	預計於八十八年底可達月產八吋晶圓16,000片
晶圓四廠	6,831	產品組合升級
晶圓三廠	3,168	產品組合升級
設備汰舊換新及其他	4,197	維持技術優勢，提升競爭能力
合計	\$25,746	

所需資金將由公司內部產生之現金流量支應

三、研究發展計畫

(一) 最近三年度研究發展費用及成果

(1) 積體電路製程研發支出

年度	金額：新台幣仟元
85年	1,493,999
86年	2,505,303
87年	3,246,165

在民國八十七年中，本公司投入了新台幣三十二億元的經費在研究發展上；而過去三年來，我們在研發上的投資大幅增加，其成長幅度甚至超越了營收的成長，充份展現本公司提供世界級尖端技術給客戶的決心。

(2) 研發成果

本公司的研究發展組織是全國也是全球專業積體電路製造服務業中最優秀的研發團隊。在民國八十七年中我們獲得了220項美國專利，其中在半導體製程技術方面，排名全球各企業第九位；同期間亦獲得170項中華民國專利，在半導體製程技術類別中，更居國內鰲頭。本公司在研發上的成就，不僅使我們獲得第七屆國家發明獎金牌獎的肯定，更榮獲經濟部頒發產業科技發展獎中之「特殊成就獎」最高榮譽，再次證明了本公司在國內及國際上的研發成就及永續經營的能力。

本公司在半導體製程技術的發展上不但居專業積體

電路製造服務領域之領導地位，並且已與世界級半導體大廠同步，推出低電壓、低功率且具高效能的邏輯製程技術。在成功地將0.25微米製程導入生產線量產後，民國八十七年本公司研發團隊又更進一步投入0.18微米邏輯製程技術的研究，並已獲致成果。本公司的0.18微米邏輯製程不但具有世界最嚴格的设计準則、非常先進的低電壓、高效能且閘長小於0.15微米的電晶體，並且以最先進的低介電常數絕緣體結合傳統鋁銅合金的方式，減低電阻/電容造成的時間延遲來大幅提昇客戶產品的速度表現。本公司的0.18微米邏輯製程技術能夠支援速度高於600MHz的微處理器及繪圖晶片，同時也提供最先進的銅製程技術供客戶選擇。我們是全球第一個推出具世界最嚴格的銅製程設計準則的專業積體電路製造服務公司。

本公司擁有全球專業積體電路製造服務產業中最大的自有光罩生產設施，協助積體電路生產製作達到最優良的品質和最短的交期。民國八十七年我們的研發團隊和光罩部門共同發展了先進的光學鄰近效應校正(OPC)和相位移轉光罩技術。這兩項技術不僅已用於0.18微米邏輯製程中，同時也會是發展下一代技術的關鍵所在。

為因應快速發展的系統單晶片應用市場的需求，本公司研發團隊率先發展嵌入式記憶體製程技術，並在民國八十七年推出了用於0.25及0.18微米邏輯製程微處理器和繪圖晶片應用的高速嵌入式靜態隨機

存取記憶體製程，更加擴大了我們系統單晶片製程技術的多種選擇性。此外，本公司也推出了用於磁碟機和多媒體應用的0.35微米嵌入式動態隨機存取記憶體製程，以及用於微控制器和無線通訊應用的0.35微米嵌入式快閃記憶體製程。這些嵌入式記憶體製程皆備有一系列完整的設計手冊和測試支援，以達到協助客戶產品設計並加速系統單晶片產品問市的目的。

在一般記憶體方面，民國八十七年本公司發展出全球最小的0.25微米四晶體(4T)靜態隨機存取記憶體製程，以及漏電度極低的四百萬位元六晶體(6T)靜態隨機存取記憶體製程，以用於需要低功耗的應用上。未來世代的嵌入式或一般記憶體製程也不斷地在研發中：例如0.15及0.13微米嵌入式靜態隨機存取記憶體、0.18微米高速、低功耗靜態隨機存取記憶體、0.25及0.18微米嵌入式動態隨機存取記憶體、0.25及0.18微米嵌入式快閃記憶體以及0.22微米EEPLD記憶體製程。

在混合訊號製程方面，本公司於民國八十七年推出具有多樣組合類比元件和被動元件的0.25微米製程，例如高品質的金屬-絕緣體-金屬電容、精準電阻、低門檻電壓元件等，它們被使用於數據機、混合數位類比訊號系統單晶片、以及一般頻率的無線通訊應用上。此外，應用於高頻及無線通訊的模組高品質電感也即將推出。為了提供更完整的系統單晶片解決方案，我們更進一步地進行下一代0.18

微米混合訊號、基地頻率以及無線通訊高頻技術的研發。

(三) 未來研發方向

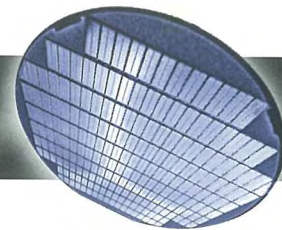
本公司一直以成為全球積體電路產業的領導者深自期許，我們的研發團隊已經展開針對未來世代之製程技術的研發，舉凡0.15、0.13及0.1微米邏輯製程、電晶體模組、光罩技術，以及其他可以使邏輯、混合訊號、高頻/無線通訊與嵌入式記憶體等製程達到高效能的製造技術，以期持續領先並滿足未來客戶對前瞻技術的需求。在民國八十八年，本公司將裝設國內第一部193nm步進掃描式微影系統機台，以利進行0.13微米技術的生產以及0.1微米技術的研發。到目前為止，本公司仍是國內唯一參與國際SEMATECH組織及十二吋晶圓專案計畫(I300I)的公司，代表我們在研發上的投入與成果已受到肯定，更確認了本公司在專業積體電路製造服務市場的領導地位。

本公司擁有業界最堅強的研發團隊，無論是在經營管理或技術領域皆有傑出的表現。我們在最先進的製程、工具和材料上的投資，還有對卓越品質的追求，都是領先同業的。本公司研發團隊致力成為客戶與夥伴「虛擬晶圓廠」的基石，不僅全力滿足客戶對先進製程技術的需求，更提供全球最佳且最具成本效益的技術解決方案，為客戶創造在市場上最強有力的競爭優勢。

我們堅持與台積合作，
開創雙贏的夥伴關係。



堅持精確詳實



- 財務資料

一、簡明資產負債表

最近五年度財務資料

項目	單位：新台幣仟元				
	83年	84年	85年	86年	87年
流動資產	7,659,444	16,070,964	16,529,359	23,790,795	26,378,422
長期股權投資	3,074,147	4,989,037	12,608,506	19,220,371	17,537,765
固定資產	14,986,932	26,643,665	41,978,952	61,697,723	73,636,209
其他資產	386,580	599,369	2,018,827	3,804,923	6,554,817
流動負債					
分配前	2,897,189	5,075,481	5,357,895	10,088,672	8,138,796
分配後	3,233,580	5,926,696	5,926,138	10,250,285	*
長期借款	3,259,206	5,556,381	5,720,000	20,009,357	25,025,206
其他負債	1,119,880	4,091,928	9,943,809	9,001,390	6,872,545
股本	7,800,000	14,390,000	26,542,000	40,813,000	60,471,760
資本公積	875	19,428	59,086	62,082	164,219
保留盈餘					
分配前	11,029,256	19,165,640	25,523,456	28,641,292	24,162,113
分配後	4,102,865	6,162,425	10,684,213	8,820,919	*
資產總額	26,107,103	48,303,035	73,135,644	108,513,812	124,107,213
負債總額					
分配前	7,276,275	14,723,790	21,021,704	39,099,419	40,036,547
分配後	7,612,666	15,575,005	21,589,947	39,261,032	*
股東權益總額					
分配前	18,830,828	33,579,245	52,113,940	69,414,393	84,070,666
分配後	18,494,437	32,728,030	51,545,697	69,252,780	*

*俟股東會決議後定案

二、簡明損益表

最近五年度財務資料

項目	單位：新台幣仟元 (除每股盈餘：新台幣元)				
	83年	84年	85年	86年	87年
銷貨收入	19,336,071	28,765,991	39,400,179	43,935,627	50,233,008
銷貨毛利	10,091,902	16,104,950	21,979,249	21,094,156	21,540,943
營業損益	8,615,119	13,897,006	18,235,246	15,489,780	16,202,245
利息收入	210,135	367,986	653,462	501,434	566,020
利息費用	197,062	258,000	277,161	546,490	981,388
稅前損益	8,580,744	14,314,528	18,972,932	15,517,103	13,648,622
稅後損益	8,474,014	15,081,273	19,400,689	17,960,075	15,344,203
每股盈餘	10.86 **	10.48 **	7.31 **	4.40 **	2.54 **
	1.41 ***	2.50 ***	3.21 ***	2.97 ***	-
利息支出資本化	15,868	102,926	181,168	255,054	661,414

* 83年至86年度損益表資料若干科目經予重新分類，俾配合87年度財務報表之表達。

** 按各年度流通在外加權平均股數計算之每股盈餘。

*** 按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘。

三、財務分析

最近五年度財務資料

項目	83年	84年	85年	86年	87年
財務結構					
負債佔資產比率 (%)	27.87	30.48	28.74	36.03	32.26
長期資金佔固定資產比率 (%)	147.40	146.89	137.77	144.94	148.16
償債能力					
流動比率 (%)	264.38	316.64	308.50	235.82	324.11
速動比率 (%)	214.33	257.83	247.77	185.78	273.86
利息保障倍數 (次)	41.22	40.38	42.40	20.04	8.91
經營能力					
應收帳款週轉率 (次)	8.55	8.12	8.80	6.22	5.90
應收帳款收現日數	42.69	44.95	41.00	58.68	61.85
存貨週轉率 (次)*	8.01	7.73	7.24	6.12	6.82
平均售貨日數*	45.57	47.22	50.43	59.69	53.49
固定資產週轉率 (次)	1.29	1.08	0.94	0.71	0.68
總資產週轉率(次)	0.74	0.60	0.54	0.41	0.40
獲利能力					
資產報酬率 (%)	41.17	41.23	32.40	20.35	14.04
股東權益報酬率 (%)	56.62	57.55	45.28	29.56	19.99
營業利益佔實收資本比率 (%)	110.45	96.57	68.70	37.95	26.79
稅前純益佔實收資本比率 (%)	110.01	99.48	71.48	38.02	22.57
純益率 (%)	43.82	52.43	49.24	40.88	30.55
每股淨值 (元)	24.14	23.34	19.63	17.01	13.90
每股盈餘 (元)	1.41 **	2.50 **	3.21 **	2.97 **	2.54
每股股利 (元)	8.00	8.00	5.00	4.50	***
現金股利 (元)	-	-	-	-	***
股票股利 (元)	8.00	8.00	5.00	4.50	***
現金流量					
現金流量比率 (%)	394.12	348.45	452.74	201.55	417.00
現金流量允當比率 (%)	103.20	111.94	113.70	97.96	102.04
現金再投資比率 (%)	34.34	31.94	28.21	16.28	21.65
槓桿度					
營業槓桿度	1.70	1.69	1.79	2.15	2.69
財務槓桿度	1.02	1.02	1.02	1.04	1.06

* 83年至86年度損益表資料若干科目經予重新分配，俾配合87年度財務報表之表達。

** 按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘。

*** 俟股東會決議後定案。

四、每股淨值、盈餘、股利及市價

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

	85年	86年	87年
每股市價			
最高	106.00	173.00	173.00
最低	49.10	55.50	56.50
平均	63.83	109.35	100.80
每股淨值			
分配前	19.63	17.01	13.90
分配後	19.42	16.97	-
每股盈餘			
加權平均股數	2,654,200,000	4,081,300,000	6,047,176,000
每股盈餘	7.31	4.40	2.54
每股盈餘 ¹	3.21	2.97	-
每股股利			
現金股利	-	-	*
無償配股			
盈餘配股	5.00	4.50	*
資本公積配股	-	-	*
投資報酬分析			
本益比 ²	8.73	24.85	39.69
本利比 ³	-	-	*
現金股利殖利率 ⁴	0	0	*

*俟股東會決議後定案

註 1. 按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘

註 2. 本益比=當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘

註 3. 本利比=當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利

註 4. 現金股利殖利率=每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價

五、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師姓名	查核意見
83年	黃樹傑、蔡紹禧	無保留意見
84年	黃樹傑、魏永篤	除採用二十二號公報外，其餘為無保留意見
85年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見
86年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見
87年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見

台北市民生東路3段156號12樓 電話：886-2-2545-9988

六、監察人審查報告書

董事會造送本公司八十七年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、主要財產之財產目錄及盈餘分派議案等，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及主要財產之財產目錄業經委託勤業會計師事務所查核完竣，並出具財務報告。上述表冊及報告經本監察人等審核，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

台灣積體電路製造股份有限公司

監察人 歐盛



監察人 胡仲英



監察人 胡新南



中華民國八十八年三月四日

七、內部控制聲明書

台灣積體電路製造股份有限公司 內部控制聲明書



日期：八十八年三月二日

本公司民國八十七年元月一日至八十七年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及管理階層之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據財政部證券暨期貨管理委員會訂頒「公開發行公司建立內部控制制度實施要點」（以下簡稱「實施要點」）規定之內部控制有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「實施要點」所採用之內部控制判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「實施要點」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司上開期間的內部控制制度，包括與營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國八十八年三月二日董事會通過，出席董事10人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣積體電路製造股份有限公司

董 事 長：張忠謀



總 經 理：曾繁城



八、財務報表暨會計師查核報告書

台灣積體電路製造股份有限公司民國八十七年及八十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國八十七年及八十六年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則，採用必要之查核程序，包括各項會計記錄之抽查在內，予以查核竣事。

據本會計師之意見，第一段所述財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則於前後一致之基礎上編製，足以公正表示台灣積體電路製造股份有限公司民國八十七年及八十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國八十七年度及八十六年度之營業成績及現金流量。

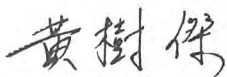
台灣積體電路製造股份有限公司已編製民國八十七年度及八十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒

勤業會計師事務所

會計師 黃樹傑

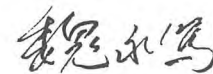


台灣省會計師公會會員證第1723號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

(83)台財證(六)第12213號

會計師 魏永篤



台灣省會計師公會會員證第705號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

(72)台財證(一)第2583號

中華民國八十八年一月二十七日

資產負債表

民國八十七年及八十六年十二月三十一日

單位：除每股面額外，為新台幣仟元

資產	八十七年底		八十六年底	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金（附註二及三）	\$8,292,152	7	\$2,534,242	2
短期投資（附註二及四）	5,661,327	5	4,970,832	5
應收關係人款項（附註十五）	234,507	-	503,040	-
應收票據	34,868	-	234,912	-
應收帳款	7,936,255	6	9,634,203	9
備抵呆帳（附註二）	(283,090)	-	(293,087)	-
備抵退貨及折讓（附註二）	(441,973)	-	(535,214)	-
存貨（附註二及五）	3,688,777	3	4,720,031	4
遞延所得稅資產（附註二及十四）	406,739	-	667,228	1
預付費用及其他流動資產（附註十五及十八）	848,860	1	1,354,608	1
流動資產合計	26,378,422	22	23,790,795	22
長期投資（附註二及六）	17,537,765	14	19,220,371	18
固定資產（附註二、七及十六）				
成本				
建築物	20,037,080	17	18,125,783	17
機器設備	77,290,435	62	64,525,249	59
辦公設備	1,657,981	1	791,462	1
	98,985,496	80	83,442,494	77
累積折舊	(40,786,249)	(33)	(26,502,409)	(24)
預付款項及未完工程	15,436,962	12	4,757,638	4
固定資產淨額	73,636,209	59	61,697,723	57
其他資產				
遞延借項－淨額（附註二）	711,822	-	641,989	-
遞延所得稅資產（附註二及十四）	5,811,827	5	3,080,099	3
存出保證金	21,918	-	73,585	-
其 他	9,250	-	9,250	-
其他資產合計	6,554,817	5	3,804,923	3
資產總計	\$ 124,107,213	100	\$ 108,513,812	100

負債及股東權益	八十七年底		八十六年底	
	金額	%	金額	%
流動負債				
應付商業本票（附註八）	\$ -	-	\$ 250,000	-
應付關係人款項（附註十五）	359,097	-	794,313	1
應付帳款	2,047,871	2	2,660,146	2
應付工程及設備款	3,181,099	3	4,965,985	5
應付所得稅（附註二及十四）	775,508	1	-	-
一年內到期之長期借款（附註九）	299,449	-	-	-
應計費用及其他流動負債	1,475,772	1	1,418,228	1
流動負債合計	8,138,796	7	10,088,672	9
長期借款（附註七及九）	2,393,489	2	8,025,900	7
可轉換公司債（附註十）	12,631,717	10	11,983,457	11
應付公司債（附註十一）	10,000,000	8	-	-
應計退休金負債（附註二及十三）	748,720	-	487,705	1
存入保證金（附註十七）	6,123,825	5	8,513,685	8
負債合計	40,036,547	32	39,099,419	36
股東權益				
股本—每股面額10元，額定—8,500,000仟股；				
發行—八十七年6,047,176仟股，				
八十六年4,081,300仟股	60,471,760	49	40,813,000	38
資本公積	164,219	-	62,082	-
法定公積	6,724,240	5	4,928,532	4
未分配盈餘	17,437,873	14	23,712,760	22
累積換算調整數（附註二）	(727,426)	-	(101,981)	-
股東權益合計	84,070,666	68	69,414,393	64
負債及股東權益總計	\$124,107,213	100	\$108,513,812	100

後附之附註係本財務報表之一部份。

損 益 表

民國八十七年及八十六年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘外，為新台幣仟元

	八十七年度		八十六年度	
	金額	%	金額	%
銷貨收入總額（附註二及十五）	\$51,441,572		\$44,765,428	
銷貨退回及折讓	(1,208,564)		(829,801)	
銷貨收入淨額	50,233,008	100	43,935,627	100
銷貨成本（附註十五）	28,692,065	57	22,841,471	52
銷貨毛利	21,540,943	43	21,094,156	48
營業費用（附註十五）				
管理費用	1,284,849	3	1,583,228	4
行銷費用	807,684	2	1,515,845	3
研究發展費用	3,246,165	6	2,505,303	6
合 計	5,338,698	11	5,604,376	13
營業利益	16,202,245	32	15,489,780	35
營業外收入				
利息收入	566,020	1	501,434	1
處分長期投資利益	756,522	2	311,453	1
處分固定資產利益	3,332	-	3,131	-
兌換淨益（附註二）	105,509	-	-	-
按權益法認列之投資淨益 （附註二及六）	-	-	17,804	-
其他收入	63,275	-	23,891	-
合 計	1,494,658	3	857,713	2
營業外費用				
利息費用（附註七）	981,388	3	546,490	1
按權益法認列之投資淨損 （附註二及六）	2,707,170	5	-	-
短期投資跌價損失	121,926	-	-	-
公司債發行成本	143,644	-	66,361	-
處分固定資產損失	2,507	-	7,722	-
兌換淨損（附註二）	-	-	188,884	1
其他損失	91,646	-	20,933	-
合 計	4,048,281	8	830,390	2
稅前利益	13,648,622	27	15,517,103	35
所得稅利益（附註二及十四）	1,695,581	3	2,442,972	6
純 益	<u>\$15,344,203</u>	<u>30</u>	<u>\$17,960,075</u>	<u>41</u>
每股盈餘				
按加權平均發行股數八十七年 6,047,176仟股及八十六年 4,081,300仟股計算	<u>\$2.54</u>		<u>\$4.40</u>	
按6,047,176仟股計算			<u>\$2.97</u>	

後附之附註係本財務報表之一部份。

股東權益變動表

民國八十七年及八十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	發行股本		資本公積 (附註二)				保留盈餘 (附註十二)			累積換算調整數 (附註二)	
	股數 (仟股)	金額	長期投資	處分固定資產利益	捐贈	合計	法定公積	未分配盈餘	合計		合計
八十六年初餘額	2,654,200	\$26,542,000	\$ -	\$59,031	\$ 55	\$59,086	\$ 2,992,429	\$22,531,027	\$25,523,456	\$(10,602)	\$52,113,940
盈餘分配											
法定公積	-	-	-	-	-	-	1,936,103	(1,936,103)	-	-	-
員工紅利											
- 現金	-	-	-	-	-	-	-	(393,994)	(393,994)	-	(393,994)
- 股票	100,000	1,000,000	-	-	-	-	-	(1,000,000)	(1,000,000)	-	-
股票股利 - 50%	1,327,100	13,271,000	-	-	-	-	-	(13,271,000)	(13,271,000)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(174,249)	(174,249)	-	(174,249)
八十六年度純益	-	-	-	-	-	-	-	17,960,075	17,960,075	-	17,960,075
處分固定資產利益轉列資本公積	-	-	-	2,996	-	2,996	-	(2,996)	(2,996)	-	-
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(91,379)	(91,379)
八十六年底餘額	4,081,300	40,813,000	-	62,027	55	62,082	4,928,532	23,712,760	28,641,292	(101,981)	69,414,393
盈餘分配											
法定公積	-	-	-	-	-	-	1,795,708	(1,795,708)	-	-	-
員工紅利-股票	129,291	1,292,910	-	-	-	-	-	(1,292,910)	(1,292,910)	-	-
股票股利 - 45%	1,836,585	18,365,850	-	-	-	-	-	(18,365,850)	(18,365,850)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(161,613)	(161,613)	-	(161,613)
八十七年度純益	-	-	-	-	-	-	-	15,344,203	15,344,203	-	15,344,203
處分固定資產利益轉列資本公積	-	-	-	3,009	-	3,009	-	(3,009)	(3,009)	-	-
按權益法認列調整被投資公司											
股權比例變動	-	-	99,128	-	-	99,128	-	-	-	-	99,128
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(625,445)	(625,445)
八十七年底餘額	<u>6,047,176</u>	<u>\$60,471,760</u>	<u>\$99,128</u>	<u>\$65,036</u>	<u>\$ 55</u>	<u>\$164,219</u>	<u>\$ 6,724,240</u>	<u>\$17,437,873</u>	<u>\$24,162,113</u>	<u>\$(727,426)</u>	<u>\$84,070,666</u>

後附之附註係本財務報表之一部份

現金流量表

民國八十七年及八十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	八十七年度	八十六年度
營業活動之現金流量：		
純 益	\$15,344,203	\$17,960,075
折舊及攤銷	14,592,897	9,762,544
遞延所得稅資產	(2,471,239)	(1,929,064)
按權益法認列之投資淨損（益）	2,707,170	(17,804)
處分長期投資利益	(756,522)	(311,453)
處分固定資產淨損（益）	(371)	9,526
應付利息補償金	875,760	433,457
應計退休金負債	261,015	158,976
備抵呆帳	(9,997)	137,460
備抵退貨及折讓	(93,241)	80,924
營業資產及負債科目之變動		
應收關係人款項	268,533	(151,151)
應收票據	200,044	(113,736)
應收帳款	1,697,948	(4,914,412)
存 貨	1,031,254	(1,969,495)
預付費用及其他流動資產	505,748	(970,741)
應付關係人款項	(435,216)	341,215
應付帳款	(612,275)	1,687,186
應付所得稅	775,508	(447,780)
應計費用及其他流動負債	57,544	588,188
營業活動之淨現金流入	<u>33,938,763</u>	<u>20,333,915</u>
投資活動之現金流量：		
短期投資增加	(690,495)	(4,970,832)
長期投資增加	(1,676,239)	(5,245,762)
處分長期投資價款	1,466,879	341,786
購置固定資產	(28,066,471)	(28,020,842)
處分固定資產價款	3,476	38,256
遞延借項增加	(322,735)	(607,028)
存出保證金減少	51,667	45,531
投資活動之淨現金流出	<u>(29,233,918)</u>	<u>(38,418,891)</u>

	八十七年度	八十六年度
理財活動之現金流量：		
應付商業本票增加（減少）	\$ (250,000)	\$ 250,000
公司債增加	9,772,500	11,550,000
長期借款增加（減少）	(5,332,962)	2,305,900
存入保證金減少	(2,389,860)	(305,637)
預收設備款增加	-	163,780
員工紅利	-	(393,994)
董監事酬勞	(161,613)	(174,249)
應付滙款調整數	(585,000)	(1,469,030)
理財活動之淨現金流入	<u>1,053,065</u>	<u>11,926,770</u>
現金及約當現金淨增加（減少）	5,757,910	(6,158,206)
年初現金及約當現金餘額	<u>2,534,242</u>	<u>8,692,448</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,292,152</u>	<u>\$ 2,534,242</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息（不含資本化利息）	<u>\$ 850,661</u>	<u>\$ 477,643</u>
支付所得稅	<u>\$ 17,457</u>	<u>\$ -</u>
不影響現金流量之投資及理財活動		
匯率影響數	<u>\$ (150,518)</u>	<u>\$ 43,774</u>
一年內到期之長期借款	<u>\$ 299,449</u>	<u>\$ -</u>
購置固定資產價款	\$ 26,281,585	\$ 30,421,300
應付工程及設備款	1,784,886	(2,400,458)
支付淨額	<u>\$ 28,066,471</u>	<u>\$ 28,020,842</u>

後附之附註係本財務報表之一部份

財務報表附註

(除另予註明者外，金額為新台幣仟元)

(一) 公司沿革

本公司係由行政院開發基金管理委員會及荷蘭商飛利浦電子股份有限公司(飛利浦公司)等共同投資設立。本公司股票於台灣證券交易所上市。八十六年十月八日起，本公司部份已發行之股票以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。

本公司主要業務為有關積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計，暨光罩之製造及設計服務。

(二) 重要會計政策之彙總說明

約當現金

約當現金係指自投資日起三個月內到期之商業本票及附買回條件政府公債。

短期投資

短期投資係按成本與市價孰低計價。出售成本則採個別辨認。

備抵呆帳

係按應收款項收回之可能性評估認列。

銷貨收入及備抵退貨及折讓

銷貨收入係於貨物移轉時認列，備抵退貨及折讓係依經驗估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售年度列為銷貨之減項，相關銷貨成本則列為銷貨成本之減項。

存貨

存貨係以成本與市價孰低計價。存貨平時按標準成本計價，結帳日時再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。市價之決定，原料、物料及零件係以重置成本為準，在製品及製成品則以淨變現價值為準。

長期投資

本公司持有股權比例達百分之二十以上且具有重大影響力之長期股權投資，係採用權益法計價；原始投資成本與取得股權時被投資公司股權淨值間之差額，係採直線法分五年平均攤銷，並列為投資損益。本公司非按原持股比例認購採權益法計價之被投資公司增發之新股，致使投資比例發生變動，因而使所投資之股權淨值發生增減者，其增減數調整「資本公積」及「長期投資」。當國外子公司之功能性貨幣為外幣時，其外幣財務報表換算後所產生之兌換差額列為股東權益項下之「累積換算調整數」。

本公司持有股權比例未達百分之二十之長期股權投資，係按成本法計價。

長期投資為上市或上櫃公司股票者，則按成本與市價孰低評價，當投資帳面金額超過該股票市價時，則改按股票市價計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失，列為股東權益之減項，若嗣後股票市價回升時，則應於已提列金額內予以沖回。

其他長期投資係投資海外基金，按成本與基金淨值孰低評價。當投資帳面金額超過該基金淨值時，則改按基金淨值計算，並提列備抵跌價損失，未實現跌價損失，列為股東權益之減項，若嗣後基金淨值回升時，則應於已提列金額內予以沖回。

股票出售時，其成本係按加權平均法計算。

固定資產

重大之增添、更新及改良列為資本支出，修理及維護支出，則列為當年度費用。固定資產於購建期間支出款項所負擔之利息予以資本化。

折舊係以直線法按下列耐用年數計提：建築物，十至二十年；機器設備，五至十年；辦公設備，三至五年。

固定資產報廢或出售時，其成本及相關之累積折舊均自帳上予以減除，出售及處分損益列為當年度損益。出售利益扣除有關所得稅後再於當年底轉列資本公積。

遞延借項

遞延借項主要係電腦軟體制度設計費用、公司債發行成本及應付短期票券發行成本，分別按三、五年及票券發行期間攤銷。

員工退休金

本公司按精算結果認列退休金費用，未認列過渡性淨給付義務係按二十五年攤提。

所得稅

本公司所得稅之會計處理係作跨期間之所得稅分攤，即將可減除暫時性差異、未使用以前年度虧損扣抵及投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列相關備抵評價金額；而應課稅暫時性差異所產生之影響數認列為遞延所得稅負債。以前年度應付所得稅之調整，列為當年度所得稅。

八十七年度（含）以後之未分配盈餘加徵百分之十之所得稅，列為股東會決議年度費用。

衍生性金融商品交易

為規避外幣淨資產或淨負債匯率風險之遠期外匯買賣合約，於訂約日以該日之即期匯率衡量入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間攤銷，應收或應付遠期外匯年底餘額，再按年底之即期匯率調整，所產生之兌換差額，列為當期損益。遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履約結清時所產生之兌換差額，列為結清年度之損益。

為規避國外企業淨投資之匯率變動風險者，兌換損益及溢折價作為股東權益之調整項目。

非以交易為目的之利率交換合約，於簽約日因無本金移轉，僅作備忘記錄，於約定結算日及資產負債表日就合約利率與市場實際利率所計得之應收或應付金額，作為被避險資產或負債有關之利息收入或利息費用之調整。

非以交易為目的之外幣選擇權合約，於訂約日不認列資產或負債，因實際交割所產生之兌換差額，則列為當期損益。購買（或出售）外幣選擇權時，所支付（或取得）之權利金於合約期間平均攤銷，列為當期損益。

以外幣為準之交易事項

非衍生性金融商品之外幣交易，係按交易當日匯率折算之新台幣金額入帳。外幣現金實際兌換成新台幣或外幣應收應付款以新台幣收付結清時，因適用不同匯率所產生之損失或盈益，列為兌換或結清年度之損益。外幣現金、資產及負債之年底餘額，按年底時之匯率予以換算，因而產生之兌換損益，則列為當期損益。

（三）現金及約當現金

	八十七年底	八十六年底
現金及銀行存款	\$ 7,453,517	\$ 2,189,808
附買回條件政府公債	804,564	-
商業本票	34,071	344,434
	<u>\$ 8,292,152</u>	<u>\$ 2,534,242</u>

（四）短期投資

	八十七年底	八十六年底
美國政府債券	\$ 4,625,769	\$ 4,582,672
外國公司債	626,844	388,160
上市上櫃公司股票	530,640	-
	5,783,253	4,970,832
備抵跌價損失	(121,926)	-
	<u>\$ 5,661,327</u>	<u>\$ 4,970,832</u>

（五）存貨

	八十七年底	八十六年底
製成品	\$ 467,368	\$ 521,950
在製品	2,346,837	2,539,137
原料	371,874	1,028,528
物料及零件	619,971	737,216
	3,806,050	4,826,831
備抵存貨損失	(117,273)	(106,800)
	<u>\$ 3,688,777</u>	<u>\$ 4,720,031</u>

(六) 長期投資

	八十七年底		八十六年底	
	帳列金額	持股比例%	帳列金額	持股比例%
股票 (股單)				
按權益法計價				
台積國際投資公司	\$ 11,096,090	100	\$12,489,962	100
世界先進積體電路公司	4,723,014	26	5,697,114	27
台灣積體電路 (美國) 公司	178,294	100	141,485	100
台灣積體電路 (歐洲) 公司	25,077	100	22,114	100
台灣積體電路 (日本) 公司	9,287	100	6,020	100
TSMC PARTNERS	9,653	100	-	-
柏成投資有限公司	100,657	25	-	-
啟信投資有限公司	100,659	25	-	-
功成投資有限公司	100,680	25	-	-
積成投資有限公司	100,661	25	-	-
欣瑞投資有限公司	100,641	25	-	-
承暉投資有限公司	100,643	25	-	-
	<u>16,645,356</u>		<u>18,356,695</u>	
按成本法計價				
台灣光罩公司 (上市公司)	32,129	2	57,032	4
台宏半導體公司	500,000	19	-	-
聯亞氣體工業公司	146,250	11	146,250	11
台灣信越半導體公司	105,000	7	105,000	7
普實創業投資公司	50,000	4	50,000	4
宏通創業投資公司	40,000	10	-	-
鑫成科技公司	-	-	505,394	17
	<u>873,379</u>		<u>863,676</u>	
基金				
CRIMSON ASIA CAPITAL	19,030	-	-	-
	<u>\$ 17,537,765</u>		<u>\$19,220,371</u>	

本公司八十七及八十六年度按權益法認列之投資淨損及淨益分別為2,707,170仟元及17,804仟元，除台灣積體電路（日本）公司財務報表未達會計師查核簽證標準外，係依各該公司同期間經會計師查核之財務報表計算。

長期投資採用成本法計價者，其有關股票市價及淨值之資料如下：

	八十七年底	八十六年底
上市公司股票市價	\$ 255,997	\$895,348
未上市按普通股持股比例之淨值	796,112	792,079
基金淨值	18,504	-

(七) 固定資產

累積折舊如下：

	八十七年底	八十六年底
建築物	\$ 5,475,083	\$ 3,686,442
機器設備	34,390,645	22,387,187
辦公設備	920,521	428,780
	<u>\$ 40,786,249</u>	<u>\$26,502,409</u>

截至八十七年底止，本公司擴建積體電路廠房及設備計畫如下：

擴廠計畫名稱	預計投資金額	累積支出金額	預訂或實際生產年月
積體電路第六廠	\$34,650,000	\$10,069,781	89.6

八十七及八十六年度利息資本化金額分別為661,414仟元及255,054仟元。

截至八十七年底止，帳列未折減餘額計6,073,544仟元之固定資產業已抵押作為長期借款之擔保品。

(八) 應付商業本票

應付商業本票係由票券金融公司保證，八十七年三月到期，年利率8.4%。

截至八十七年底止，本公司尚未使用之短期借款額度為7,232,200仟元。

(九) 長期借款

	八十七年底	八十六年底
新台幣銀行借款：		
銀行承兌匯票—八十七年		
為八十八年十二月前還清，		
年利率為6.95%；八十六年		
為八十九年十月前還清，		
年利率為8.25%~8.50%（已於八十七年九月提前清償）	\$ 299,449	\$ 1,680,000
商業本票—九十二年五月前還清，年利率7.00%~7.08%	2,393,489	-
美金銀行借款：		
美金156,000仟元，自八十六年		
六月起每半年償還，至九十年		
十二月還清，年利率為7.03%		
（已於八十七年五月提前清償）。	-	5,148,000
美金36,300仟元，分別至八十八年		
十月前還清，年利率為5.96%~6.56%		
（已於八十七年四月提前清償）。	-	1,197,900
小 計	2,692,938	8,025,900
一年內到期部份	(299,449)	-
	<u>\$ 2,393,489</u>	<u>\$ 8,025,900</u>

截至八十七年底止，本公司尚未使用之長期借款額度為 6,191,010仟元。

(十) 可轉換公司債

本公司於八十六年七月三日發行海外第一次有擔保可轉換公司債美金350,000仟元（折合新台幣11,322,500仟元），票面年利率為零，本金及依利息法攤計之利息補償金計1,309,217仟元於九十一年七月三日到期時一次償還。依轉換辦法規定，轉換價格於發行時訂為每股144元（嗣後則依公式調整），債權人於發行之日起滿四十天後至到期前五日止，得依規定請求轉換為本公司換股權利證書；當符合特定條件時，本公司得享有債券贖回權。截至八十七年底止，此項公司債尚未有轉換為普通股者。

(十一) 應付公司債

本公司於八十七年三月四日發行國內第一次無擔保普通公司債，發行總額4,000,000仟元，票面年利率7.71%，每半年付息一次，至九十二年三月四日到期一次償還。

本公司分別於八十七年十一月十八日至十二月一日間分次發行國內第二次無擔保公司債，面額總計6,000,000仟元，票面利率皆為7.12%，每年付息一次，分別於九十二年十一月底到期，到期一次償還。本公司債券持有人得於本公司債發行日後屆滿第二年及第三年之日前三十日，要求本公司於本公司債屆滿第二年或第三年之日，以債券面額加計當期應計利息後，行使債券贖回權；本公司亦可依上述條件行使債券贖回權。

(十二) 股東權益

依據公司法之規定，資本公積只能用於彌補虧損或撥充股本。

依據本公司章程規定，每年度純益於彌補虧損後，應分配如下：

1. 先提撥百分之十為法定公積；
2. 次提其餘額百分之一為董監事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利；
3. 剩餘部份依股東會決議分派之。

上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認，並於該年度入帳。

依公司法之規定，法定公積應繼續提撥至其總額達股本總額為止。法定公積得用以彌補虧損；且當該項公積已達實收股本百分之五十時，亦得以其半數撥充股本。

本公司計算分配股東可扣抵稅額時，若分配屬於八十六年度（含）以前未分配盈餘時，股東將不獲配股東可扣抵稅額。若分配屬於八十七年度（含）以後未分配盈餘時，則股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東可扣抵稅額。

本公司截至八十七年底，未分配盈餘餘額包括：

八十六年及以前年度未分配盈餘	\$ 2,096,679
八十七年及以後年度未分配盈餘	<u>15,341,194</u>
	<u>\$17,437,873</u>

截至八十八年一月二十七日股東可扣抵稅額餘額為22,633仟元，佔八十七年度未分配盈餘之比率為0.15%。由於本公司得分配予股東之可扣抵稅額，應以股利盈餘分配日之股東可扣抵稅額帳戶之餘額為計算基礎。因是本公司股東於受配八十七年度盈餘時，所適用之稅額扣抵比率，尚需調整盈餘分配日前，本公司依所得稅法規定可能產生之各項可扣抵稅額。

(十三) 員工退休金

本公司對正式員工訂有退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休時之平均薪資計算。本公司每月按員工薪資總額百分之二提撥員工退休基金，交由職工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶。

本公司退休金相關資訊揭露如下：

淨退休金成本為：

	八十七年度	八十六年度
服務成本	\$ 212,398	\$ 198,503
利息成本	69,390	50,564
退休基金資產預期報酬	(16,992)	(12,875)
攤銷數	8,300	8,300
淨退休金成本	<u>\$ 273,096</u>	<u>\$ 244,492</u>

退休基金提撥狀況與帳載應計退休金負債之調節如下：

	八十七年底	八十六年底
給付義務		
既得給付義務	\$ 579	\$ 446
非既得給付義務	310,430	<u>260,849</u>
累積給付義務	311,009	261,295
未來薪資增加之影響數	817,006	<u>729,989</u>
預計給付義務	1,128,015	991,284
退休基金資產公平價值	(287,493)	<u>(212,851)</u>
提撥狀況	840,522	778,433
未認列前期服務成本	-	-
未認列過渡性淨給付義務	(182,591)	(190,891)
未認列退休金（損）益	91,059	(55,914)
補列之退休金負債	-	-
應計退休金負債	<u>\$ 748,990</u>	<u>\$ 531,628</u>

退休金給付義務及計算退休金成本之假設為：

折現率	7%	7%
未來薪資水準增加率	6.5%	7%
退休基金資產預期投資報酬率	7%	7%

退休金提撥及支付情況

本期提撥	<u>\$ 51,055</u>	<u>\$ 44,747</u>
本期支付	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

(十四) 所得稅

	八十七年度	八十六年度
按法定稅率（20%）計算之稅額	\$ 2,729,724	\$ 3,103,421
免稅所得減付之稅額	(1,413,371)	(2,432,733)
其他	(19,353)	(5,688)
本期應負擔稅額	1,297,000	665,000
所得稅抵減	(751,492)	(665,000)
本期應付	545,508	-
遞延所得稅資產淨變動		
— 投資抵減	(2,590,089)	(2,579,214)
— 暫時性差異	119,000	-
遞延所得稅備抵評價調整數	-	650,150
以前年度所得稅調整	230,000	(513,908)
所得稅利益	<u>\$ (1,695,581)</u>	<u>(\$ 2,442,972)</u>

遞延所得稅資產（負債）明細如下：

	八十七年底	八十六年底
流動		
投資抵減	<u>\$ 406,739</u>	<u>\$ 667,228</u>
非流動		
投資抵減	\$ 5,930,827	\$ 4,450,249
備抵評價金額	-	(1,370,150)
暫時性差異	247,844	-
折舊	(366,844)	-
淨額	<u>\$ 5,811,827</u>	<u>\$ 3,080,099</u>

截至八十七年底止，未使用之機器設備及研究發展費用投資抵減，得用以抵減以後年度應納稅額如下：

到期年度	投資抵減金額
八十九	\$ 1,327,847
九十	3,747,512
九十一	1,262,207

截至八十七年底止，本公司各次增資擴展可享受四年免稅如下：

增資擴展案	免稅期間
電腦輔助設計	八十三年至八十六年度
一廠及二廠之擴建	八十三年至八十六年度
二廠擴建、電腦輔助設計擴充及新增三廠	八十五年至八十八年度
一廠、二廠第一、二生產單位及三廠擴建、新增四廠	八十六年至八十九年度

本公司截至八十五年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。

(十五) 關係人交易

除已於財務報表及其他附註中揭露者外，重大之關係人交易及餘額彙總如下：

1. 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
工研院	本公司董事長為工研院之董事
飛利浦公司	本公司主要股東之一
台積國際投資公司	本公司之子公司
台灣積體電路（美國）公司（美國子公司）	本公司之子公司
台灣積體電路（歐洲）公司（歐洲子公司）	本公司之子公司
台灣積體電路（日本）公司（日本子公司）	本公司之子公司
鑫成科技公司	被投資公司（已於八十七年一月處分所有持股）
世界先進積體電路公司(世界先進公司)	被投資公司
WAFERTECH, LLC	本公司子公司（台積國際投資公司）間接持有之被投資公司
TSMC TECHNOLOGY	本公司子公司（台積國際投資公司）間接持有之被投資公司

2. 關係人交易

	八十七年		八十六年	
	金額	百分比	金額	百分比
全年度				
銷貨收入				
工研院	\$ 173,375	-	\$ 240,549	1
飛利浦及其聯屬公司	3,422,090	7	3,150,057	7
世界先進公司	65,301	-	27,681	-
WAFERTECH, LLC	38,452	-	8,986	-
	<u>\$ 3,699,218</u>	<u>7</u>	<u>\$ 3,427,273</u>	<u>8</u>
租金費用				
工研院	<u>\$ 161,477</u>	<u>67</u>	<u>\$ 161,023</u>	<u>80</u>
製造費用				
飛利浦公司（技術報酬金）	<u>\$ 637,136</u>	<u>100</u>	<u>\$ 777,144</u>	<u>100</u>
鑫成科技公司（加工費）	<u>\$ -</u>	<u>-</u>	<u>\$ 282,675</u>	<u>42</u>
行銷費用				
美國子公司（佣金）	\$ 388,513	48	\$ 889,298	59
美國子公司（服務費）	78,448	10	41,101	3
歐洲子公司（佣金）	51,665	6	150,964	10
日本子公司（佣金）	25,975	3	-	-
	<u>\$ 544,601</u>	<u>67</u>	<u>\$ 1,081,363</u>	<u>72</u>
年底餘額				
應收關係人款項				
工研院	\$ 30,668	13	\$ 50,781	10
飛利浦及其聯屬公司	162,750	69	362,576	72
世界先進公司	7,884	3	3,532	1
日本子公司	17,550	8	-	-
WAFERTECH, LLC	6,405	3	86,141	17
TSMC TECHNOLOGY	9,250	4	-	-
歐洲子公司	-	-	10	-
	<u>\$ 234,507</u>	<u>100</u>	<u>\$ 503,040</u>	<u>100</u>

預付費用及其他流動資產				
預付租金－工研院	\$	42,462	9	\$ 42,277 2
應付關係人款項				
飛利浦及其聯屬公司	\$	155,086	43	\$ 199,725 25
美國子公司		60,746	17	503,505 63
歐洲子公司		10,713	3	88,903 12
日本子公司		9,603	3	- -
WAFERTECH, LLC		122,949	34	- -
鑫成科技公司		-	-	2,180 -
	\$	359,097	100	\$ 794,313 100

上列與關係人交易之價格及收付款條件均與非關係人相當。

(十六) 重大長期營業租賃

本公司積體電路第一廠之土地、廠房及部份機器設備係向工業技術研究院（工研院）承租，至九十一年三月底止。目前年租金為169,848仟元（含服務費及管理費），租約到期時雙方可協議續約。

本公司積體電路第二廠至第十廠之土地係向科學工業園區管理局承租，租期分別於九十七年三月至一〇七年四月間到期。租金每年共計42,149仟元，到期時可再續約。

前述租約未來五年及以後年度之租金如下：

年度	金額
八十八	\$ 211,997
八十九	211,997
九十	211,997
九十一	84,611
九十二	42,149
九十三至一〇七	354,188
	<u>\$1,116,939</u>

(十七) 承諾事項

截至八十七年底止，重大承諾事項如下：

- 1.與飛利浦公司簽訂技術合作合約，自七十七年一月一日起，按約定產品銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金。合約有效期間為十年；除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。本公司已於八十六年五月十二日與飛利浦公司修訂上述合約，自八十六年七月九日起生效，合約延展十年，並於到期後自動展期，每次三年。依據上述修訂合約之規定，自修訂合約生效滿五年後，本公司若須支付權利金予任何第三人，該金額可自應支付予飛利浦公司之技術報酬金中扣除，惟每年應支付之技術報酬金仍不得低於特定比例。
- 2.於符合特定股權條件，承諾飛利浦及其聯屬公司每年得預訂本公司最高達百分之三十之產能，惟應於合理期間前通知。
- 3.與工研院簽訂次微米技術授權契約，於五年內支付授權費129,400仟元（含5%加值型營業稅，業已全數支付），並按約定產品銷貨收入淨額之一定百分比支付權利金至八十七年底止。另與工研院簽訂技術合作契約，本公司應於契約有效期限內提供經濟部及其指定對象最高達35%之產能。
- 4.與TSMC Development, Inc.（台積國際投資公司之子公司）共同簽訂一製造合約。依該約規定，須於WAFERTECH, LLC（TSMC Development, Inc.投資設立之晶圓代工廠）量產後三年內，向其購買至少百分之八十五之產能；若不購足，本公司應就未購足部份產品價款扣除未投入成本後之淨額賠償TSMC Development, Inc.，TSMC Development, Inc.已將此合約之權利讓與WAFERTECH, LLC。
- 5.本公司與三家客戶共同簽訂一供應及購買合約。依該約規定，本公司有義務提供且三家客戶有義務購買特定比例之WAFERTECH, LLC產能。若各合約當事人無法供應或購足其承諾之產能時，應就未供應或購足部份產品價款扣除未支出成本後之金額，賠償本約他方當事人。
- 6.與若干主要客戶簽訂晶圓代工合約，依合約之規定本公司以預收保證金之方式保留一定產能予該等客戶。截至八十七年底止，該等存入保證金計美金189,058仟元（帳列其他負債）。
- 7.本公司經財政部臺灣省北區國稅局於八十七年二月二十七日重新核定應補繳八十三及八十四年度營利事業所得稅計約230,000仟元，係臺灣省北區國稅局以本公司積體電路第一廠所在地非屬科學工業園區之範圍，依法當補繳各該年度之營利事業所得稅。本公司不服其核定，除依法提起行政救濟外，並採保守原則暫將營利事業所得稅估列入帳。

(十八) 衍生性金融商品交易

本公司八十七年及八十六年度從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率及利率波動所產生之風險，本公司之避險策略係以達成能夠規避大部份市場價格風險為目的，均屬非以交易為目的之避險活動，茲將有關資訊揭露如下：

1. 遠期外匯買賣合約：

截至八十七年及八十六年底止，尚未到期之遠期外匯合約金額如下：

	幣別	合約金額 (仟元)	公平價值 (仟元)	到期日	到期值 (仟元)
八十七年底					
買入遠期外匯	美金	USD111,000	NTD 3,574,885	88年1月	NTD 3,580,421
賣出遠期外匯	美金	USD 40,000	NTD 1,296,959	88年1月~2月	NTD 1,262,120
八十六年底					
買入遠期外匯	美金	USD690,000	NTD23,195,820	87年1月~12月	NTD22,418,570
賣出遠期外匯	美金	USD470,000	NTD15,872,710	87年1月~12月	NTD15,256,960

本公司八十七年及八十六年底因遠期外匯買賣合約所產生之應收款項（帳列其他流動資產）分別為21,572仟元及375,106仟元，於八十七年及八十六年度產生之兌換淨益分別為336,807仟元及1,962,920仟元。

上述遠期外匯合約係為規避下列淨資產或淨負債之匯率變動風險。

淨資產或淨負債	單位：美金仟元	
	八十七年底	八十六年底
應收帳款	\$ 206,926	\$236,831
存入保證金	189,058	-
應付帳款	66,397	138,331
可轉換公司債	-	363,135
長期股權投資	-	389,645
長期借款	-	156,000

2. 利率交換合約

本公司與數家銀行簽訂利率交換合約，以固定區間利率換取浮動利率，用以規避長期借款採浮動利率計息產生之利率變動風險，八十七年度產生之利息支出為13,367仟元。截至八十七年底止，本公司簽訂之利率交換合約彙總如下：

合約簽訂日	期間	合約金額(仟元)
87年4月28日	87年5月21日~92年5月21日	2,000,000
87年4月29日	87年5月21日~92年5月21日	1,000,000
87年6月26日	87年6月26日~92年6月26日	1,000,000
87年6月26日	87年7月6日~92年7月6日	1,000,000

3. 外幣選擇權

本公司八十七年度因預期將自外銷銷貨取得美金收入，故與銀行簽訂外幣選擇權合約，以規避外幣匯率波動所可能造成之不利影響。截至八十七年底止，本公司所簽訂之外幣選擇權合約皆已到期，取得之權利金收入為8,280仟元。

本公司八十六年度未從事任何外幣選擇權交易。

4. 交易風險

- (1) 信用風險－本公司交易對象皆為國內信用良好之金融機構，預期不致產生重大信用風險。
- (2) 市場價格風險－本公司從事衍生性金融商品交易即在規避外幣淨資產或淨負債因匯率或利率波動所產生之風險，因是匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷，而利率風險亦因預期之資金成本已固定，故市場價格風險並不重大。
- (3) 流動性風險及現金流量風險－本公司從事遠期外匯交易即在規避淨資產或淨負債之匯率變動風險，因到期時有相對之現金流入或流出，本公司之營運資金足以支應，而利率交換合約之利率亦已考量本公司未來資金成本所訂定，故無籌資風險。因遠期外匯合約之匯率及利率交換合約之利率已確定，不致有重大之現金流量風險。

5. 金融性商品之公平價值

	八十七年底		八十六年底	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
非衍生性金融商品				
資產				
現金及約當現金	\$ 8,292,152	\$ 8,292,152	\$2,534,242	\$2,534,242
短期投資	5,661,327	5,691,566	4,970,832	4,982,339
應收關係人款項	234,507	234,507	503,040	503,040
應收票據及帳款	7,971,123	7,971,123	9,869,115	9,869,115
負債				
應付關係人款項	359,097	359,097	794,313	794,313
應付帳款	2,047,871	2,047,871	2,660,146	2,660,146
應付工程及設備款	3,181,099	3,181,099	4,965,985	4,965,985
長期負債（含一年內到期部份）	2,692,938	2,692,938	8,025,900	8,025,900
可轉換公司債	12,631,717	11,932,484	11,983,457	11,311,440
應付公司債	10,000,000	10,015,720	-	-
衍生性金融商品				
買入遠期外匯	3,590,850	3,574,885	22,770,000	23,195,820
賣出遠期外匯	1,294,000	1,296,959	15,510,000	15,872,710
利率交換合約	7,423	7,423	-	-

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- (1) 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平市價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。
- (2) 短期投資係以市場價格為公平價值。
- (3) 長期負債以其預期現金流量之折現值估計公平價值。折現率則以本公司所能獲得類似條件之長期負債利率為準。本公司之長期負債利率除公司債外，均屬浮動利率，其帳面價值即為公平市價，故僅評估公司債之折現值。
- (4) 本公司係以銀行報價所顯示之外匯換匯匯率及利率，就個別遠期外匯合約到期日之遠期匯率及利率交換合約分別計算個別合約之公平價值。

(十九) 部門別資訊

1. 外銷銷貨資訊

本公司之外銷銷貨明細如下：

地區	八十七年度	八十六年度
美 國	\$ 26,438,864	\$ 18,987,227
歐 洲	3,595,809	3,594,183
新 加 坡	3,463,638	5,000,890
日 本	2,520,463	4,730,973
其 他	3,683,252	683,147
	<u>\$ 39,702,026</u>	<u>\$ 32,996,420</u>

2. 重要客戶資訊

佔本公司銷貨收入百分之十以上之客戶：無

九、財務狀況及經營結果之檢討分析

(一) 流動分析

項目	八十七年	八十六年	增減比率
	12月31日	12月31日	
流動比率	324.11%	235.82%	37.44%
速動比率	273.86%	185.78%	47.41%

(二) 經營結果分析

項目	八十七年度	八十六年度	單位：新台幣仟元	
			增減金額	增減比率
銷貨收入總額	\$ 51,441,572	\$ 44,765,428	6,676,144	14.91%
銷貨退回折讓	(1,208,564)	(829,801)	(378,763)	45.65%
銷貨收入淨額	50,233,008	43,935,627	6,297,381	14.33%
銷貨成本	28,692,065	22,841,471	5,850,594	25.61%
銷貨毛利	21,540,943	21,094,156	446,787	2.12%
營業費用	5,338,698	5,604,376	(265,678)	(4.74%)
營業利益	16,202,245	15,489,780	712,465	4.60%
營業外收入				
利息收入	566,020	501,434	64,586	12.88%
按權益法認列之投資收益	-	17,804	(17,804)	(100.00%)
處分長期股權投資利益	756,522	311,453	445,069	142.90%
處分固定資產利益	3,332	3,131	201	6.42%
兌換淨益	105,509	-	105,509	-
其他收入	63,275	23,891	39,384	164.85%
營業外收入合計	1,494,658	857,713	636,945	74.26%
營業外費用				
利息費用	981,388	546,490	434,898	79.58%
按權益法認列之投資淨損	2,707,170	-	2,707,170	-
短期投資跌價損失	121,926	-	121,926	-
處分固定資產損失	2,507	7,722	(5,215)	(67.53%)
兌換淨損	-	188,884	(188,884)	(100.00%)
公司債發行成本	143,644	66,361	77,283	116.46%
其他損失	91,646	20,933	70,713	337.81%
營業外費用合計	4,048,281	830,390	3,217,891	387.52%
稅前利益	13,648,622	15,517,103	(1,868,481)	(12.04%)
所得稅利益	1,695,581	2,442,972	(747,391)	(30.59%)
純益	<u>\$ 15,344,203</u>	<u>\$ 17,960,075</u>	(2,615,872)	(14.56%)

十、合併財務報表

合併資產負債表

民國八十七年及八十六年十二月三十一日

單位：除每股面額外，為新台幣仟元

資產	八十七年底		八十六年底	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 9,679,273	7	\$ 12,816,004	10
短期投資	5,906,339	4	5,046,150	4
應收關係人款項	201,301	-	416,889	-
應收票據	34,868	-	234,912	-
應收帳款	7,940,062	6	9,478,009	8
備抵呆帳	(283,090)	-	(293,087)	-
備抵退貨及折讓	(441,973)	-	(535,214)	-
存貨	4,056,508	3	4,876,292	4
遞延所得稅資產	411,350	-	816,788	1
預付費用及其他流動資產	1,035,862	1	1,463,931	1
流動資產合計	<u>28,540,500</u>	<u>21</u>	<u>34,320,674</u>	<u>28</u>
長期投資	<u>6,659,117</u>	<u>5</u>	<u>7,162,460</u>	<u>6</u>
固定資產				
成本				
土地	807,087	-	253,652	-
建築物	27,010,514	19	18,125,783	14
機器設備	88,466,784	63	64,525,249	52
辦公設備	2,312,238	2	962,776	1
	118,596,623	84	83,867,460	67
累積折舊	(41,489,543)	(29)	(26,552,281)	(21)
預付款項及未完工程	21,594,489	15	21,789,463	17
固定資產淨額	<u>98,701,569</u>	<u>70</u>	<u>79,104,642</u>	<u>63</u>
其他資產				
遞延借項-淨額	773,637	-	641,989	1
遞延所得稅資產	6,039,395	4	3,276,063	2
存出保證金	23,755	-	73,585	-
其他	23,509	-	22,734	-
其他資產合計	<u>6,860,296</u>	<u>4</u>	<u>4,014,371</u>	<u>3</u>
資產總計	<u>\$ 140,761,482</u>	<u>100</u>	<u>\$ 124,602,147</u>	<u>100</u>

負債及股東權益	八十七年底		八十六年底	
	金額	%	金額	%
流動負債				
應付商業本票	\$ -	-	\$ 250,000	-
應付關係人款項	155,086	-	201,905	-
應付帳款	2,176,023	2	3,136,944	3
應付工程及設備款	3,601,832	3	10,099,466	8
應付所得稅	777,424	-	3,367	-
一年內到期之長期借款	299,449	-	-	-
應計費用及其他流動負債	1,773,804	1	1,639,640	1
流動負債合計	8,783,618	6	15,331,322	12
長期借款	8,620,864	6	8,025,900	6
應付公司債	22,631,717	17	11,983,457	10
應計退休金負債	750,222	-	489,117	-
其他負債				
存入保證金	6,123,825	4	8,516,482	7
預收設備款	79,689	-	-	-
少數股權	9,700,881	7	10,841,476	9
負債合計	56,690,816	40	55,187,754	44
股東權益				
股本 -- 每股面額10元，額定-8,500,000仟股：				
發行-八十七年6,047,176仟股，				
八十六年 4,081,300仟股	60,471,760	43	40,813,000	33
資本公積	164,219	-	62,082	-
法定公積	6,724,240	5	4,928,532	4
未分配盈餘	17,437,873	12	23,712,760	19
累積換算調整數	(727,426)	-	(101,981)	-
股東權益合計	84,070,666	60	69,414,393	56
負債及股東權益總計	\$ 140,761,482	100	\$ 124,602,147	100

合併損益表

民國八十七年及八十六年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘外，為新台幣仟元

	八十七年度		八十六年度	
	金額	%	金額	%
銷貨收入總額	\$ 51,645,934		\$ 44,756,442	
銷貨退回及折讓	(1,223,521)		(829,801)	
銷貨收入淨額	50,422,413	100	43,926,641	100
銷貨成本	31,077,743	62	22,841,471	52
銷貨毛利	19,344,670	38	21,085,170	48
營業費用				
管理費用	1,555,927	3	2,194,186	5
行銷費用	735,216	2	1,457,281	3
研究發展費用	3,246,165	6	2,505,303	6
合計	5,537,308	11	6,156,770	14
營業利益	13,807,362	27	14,928,400	34
營業外收入				
利息收入	704,928	1	954,748	2
處分長期投資利益	781,647	2	310,561	1
處分固定資產利益	3,332	-	3,131	-
兌換淨益	105,509	-	-	-
其他收入	63,348	-	26,376	-
合計	1,658,764	3	1,294,816	3
營業外費用				
利息費用	1,026,936	2	546,591	1
按權益法認列之投資損失	1,400,026	3	64,440	-
短期投資跌價損失	121,926	-	-	-
公司債發行成本	143,644	-	66,361	-
處分固定資產損失	4,421	-	7,722	-
兌換淨損	-	-	188,884	1
其他損失	105,430	-	20,932	-
合計	2,802,383	5	894,930	2
稅前利益	12,663,743	25	15,328,286	35
所得稅利益	1,664,852	3	2,558,516	6
扣除少數股權前利益	14,328,595	28	17,886,802	41
少數股權損失	1,015,608	2	73,273	-
純益	<u>\$ 15,344,203</u>	<u>30</u>	<u>\$ 17,960,075</u>	<u>41</u>
每股盈餘				
按加權平均發行股數八十七年6,047,176				
仟股及八十六年4,081,300仟股計算	<u>\$2.54</u>		<u>\$4.40</u>	
按6,047,176仟股計算			<u>\$2.97</u>	

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長 張忠謀



刊印日期：民國八十八年三月二十八日



台灣積體電路製造股份有限公司
新竹科學工業園區園區三路121號
電話：886-3-578-0221 傳真：886-3-578-1546
<http://www.tsmc.com.tw>